



VIA

VIA Technologies Japan 株式会社

製品カタログ

2026 - 2027

目次

目次

VIA グループ	2
VIA のコアコンピタンス	4
VIA 組込み ARM ソリューション	6

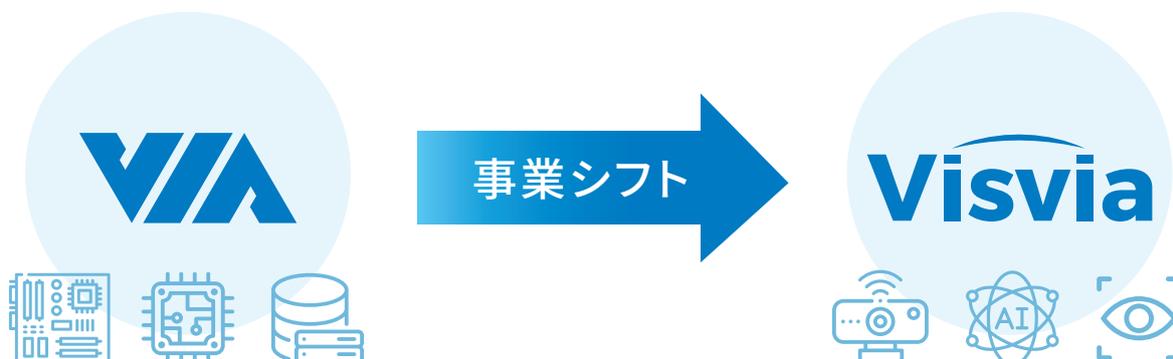
特集

VIA 組込み向け Android 開発用ツール～ Smart ETK	7
Smart ETK を使用するメリット	8
VIA Edge AI Solution	10
AI/IoT 製品 向けプラットフォーム	12
クロスプラットフォーム AI の最適解	14
エッジ AI 特化型ソリューション	16
次世代産業向け AI ソリューション	18
MaaS 向けソリューション	20
AI フォークリフト安全システム	22
LLM 特集	24
外観検査特集	26

AI/IoT 製品 28

SOM-8600	29	ACS-5000	36
SOM-7200	29	EPIA-M930	36
SOM-7000	30	AMOS-9100 Series	37
SOM-5200	30	AMOS-9000	37
SOM-5000	31	AMOS-3007	38
SOM-4200	31	AMOS-5200	38
SOMDB8	32		
SOM-7X25	32	VIA Mobile360 製品	39
OSM-7200	33	VIA Mobile360 D800	40
OSM-5200	33	VIA Mobile360 M500	40
OSM-4200	34	VIA Mobile360 J600	41
VAB-5200	34		
VAB-5000	35		
ARTiGO A5000	35		

VIA から VISVIA へ ～進化の道筋～



コンピュータビジョン技術を核として、エッジAIベースのDMS専門チームが
包括的なエンドツーエンドソリューションを提供。

VIA Technologies, Inc

VIA Technologies, Inc. は、業務の安全性と効率性を変革するインテリジェントな車載、エッジ、産業機器、ビルディングソリューションにより、高度な AI、IoT、コンピュータビジョン技術と企業を結び付ける世界的なリーダー企業です。

VIA は、PC 用コアロジックチップセットの開発に特化した工場を持たない半導体設計会社として、1987 年に米国カリフォルニア州のフリーモントで設立されました。当社は 1992 年、台湾とアジアにおいて重要かつ成長を見せている IT 製造拠点との緊密なパートナーシップを構築するために、本社を台湾の台北に移しました。

1990 年代、VIA は Intel および AMD プラットフォーム向けの画期的なコアロジックチップセットを次々と打ち出し、世界的な市場リーダーとしての地位を確立しました。1999 年には、次世代の高集積・低消費電力プラットフォームの必要性をいち早く予見し、National Semiconductor から Cyrix を、IDT から Centaur Technology を買収することで x86 マイクロプロセッサ市場へ本格参入を果たしました。

さらに 2001 年の S3 Graphics 設立や通信・USB コントローラ技術の拡充を経て、VIA C3、Eden、Nano といった低消費電力プロセッサの歴代製品を市場に導入しました。これらの技術資産を礎に、産業・医療・スマートシティ等の広範な組み込みシステムにおいて、現在も業界標準となっている Mini-ITX や Pico-ITX といった超小型マザーボードのフォームファクタを先駆けて開発し、コンピューティングの新たな可能性を切り拓き続けています。

VIA から VISVIA へ：継承と飛躍のブランド刷新

「VISVIA」の誕生は、私たちの伝統の継承と、次世代テクノロジーへの飛躍的な融合を意味します。このリブランディングは、単なる名称変更にとどまらず、私たちがエッジ AI・ビジョンソリューションのプロバイダーとして新たなステージへ進化したことを宣言するものです。

長年、私たちはコンピュータビジョン、インテリジェント・セキュリティ・システム、およびエッジ AI (Edge AI) の分野を深耕し、世界中のお客様へ揺るぎない技術的バックボーンを提供してまいりました。

「VISVIA」という命名は、単に Vision (ビジョン) と VIA (ヴィア・テクノロジーズ) を融合させただけではありません。それは、お客様が持つ技術やアイデアを、私たちが「真の産業競争力」へと転換させるための力になる、という強い決意を象徴しているのです。



VIA インテリジェントエッジソリューション

VIA インテリジェントエッジソリューションは、高集積のモジュール、ボード、スターターキット、システムの幅広い選択肢で構成され、小売、商用、産業用の革新的なエッジ AI デバイスの市場投入までの時間を短縮します。高度なコンピューティングおよび AI 性能と、低消費電力および I/O・接続の豊富な機能を結び付けた VIA インテリジェントエッジソリューションには、システム開発を容易にする Android や Linux の BSP (ボードサポートパッケージ) も付属しています。

最高水準の品質と信頼性により構築された当社のプラットフォームは、長期間の製品ライフサイクルをサポートするため、長期安定供給を実現しています。



VIA インテリジェント車載ソリューション

VIA インテリジェント車載ソリューションには、幅広い VIA Mobile360 のシステムおよびデバイスが含まれ、AI を活用した人検出およびドライバー安全システム技術の包括的なパッケージを活用して、オンロード・オフロードの商用車両における事故を防止し、効率性を高めます。堅牢かつ高信頼性の幅広いフォームファクタで利用可能な VIA インテリジェント車載ソリューションは、採掘や建設に用いられる掘削機や運搬トラックから、物流や輸送に用いられるフォークリフトや配送用バンまで、特定の導入要件を満たすために、あらゆるサイズ・種類の商用車両および産業用車両に搭載することができます。

VIA Fleet および VIA WorkX プラットフォームを使用したシームレスなクラウド接続により、管理者は豊富なリアルタイムの IoT およびビデオデータを使用して、車両運行上の安全性と効率性を最適化することができます。



VIA インテリジェント産業機器ソリューション

VIA インテリジェント産業機器ソリューションは、最適化された AI 外観検査モデルおよび強力なエッジ AI 機能を活用して、パイプライン溶接、ビニール袋の製袋加工、シリコンウェハといったさまざまな項目の不良検出におけるスピードと精度を向上させます。

また、煙、火災、個人用保護具の安全性検査ソリューションも利用可能であり、商品や施設の損傷を防ぎ、潜在的な安全上の脅威から従業員を保護します。すべてのソリューションは、最新の AI、コンピュータビジョン、産業機器用 IoT 技術を活用して、特定の導入要件に合わせてカスタマイズすることが可能です。



VIA インテリジェントビルディングソリューション

VIA インテリジェントビルディングソリューションには、住宅用および商業用の導入に理想的な最先端のカメラと接続技術を統合したスマートアクセス制御、ビデオインターホン、ドアフォン、アラームシステムなどがすべて含まれています。特定の導入ニーズを満たす、柔軟なカスタマイズオプションが利用可能です。

x86

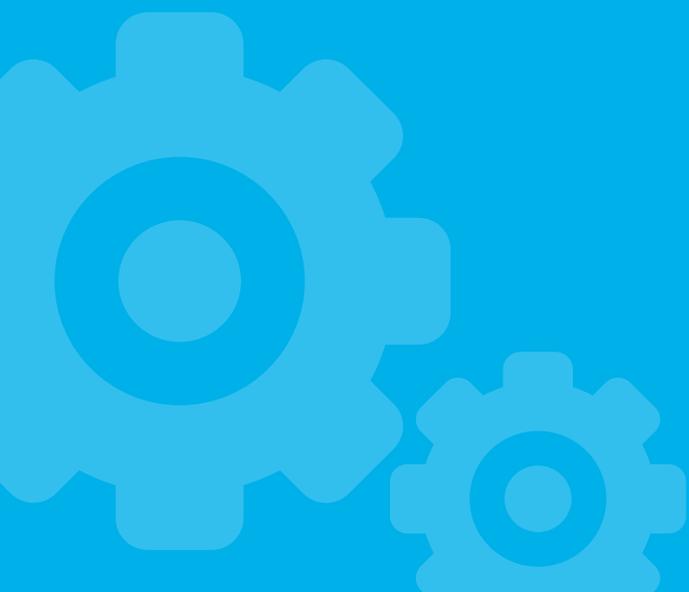
ARM



VIA のコアコンピタンス

1987年の設立以来、チップセットのリーディングカンパニーとして業界の最先端を走ってきたVIA。しかし、私たちがご提供できる製品は、チップセットだけではありません。VIAは、各種ハードウェアはもちろん、ハードウェアの性能を最大限に引き出すミドルウェアの開発支援、半導体レベルからのサポートまでを含めたシステムをご提案のできるソリューションメーカーなのです。

お客様システムに合わせてほかのボードメーカーが実現できないBIOSのカスタマイズやドライバのチューニングができること。ボード、システムの心臓部となるCPU、チップセット、周辺ICを熟知していることによる高い問題解決力。それらが私たちの最大の武器となっています。



優れたコストパフォーマンス



VIA は、お客様のご要望に合わせて、最もコストパフォーマンスの高いソリューションをご提案します。VIA のソリューションなら、ドライバのチューニングやソフトウェア開発支援によって、ハードウェアの性能を最大限まで引き出し、TCO(Total Cost of Ownership) を抑えながら、お客様が求める必要なパフォーマンスを実現させることができるのです。

トータルソリューション提案



VIA が顧客に対して提案できるものは、単なるマザーボードに留まらず、顧客が実現したいことを具体的な形で（ハードウェア+ソフトウェアを通したシステム観点から）ご提案できることが重要なポイントだと考えています。顧客に製品コンセプトやビジネスモデルに注力していただき、VIA がそのアイデアを製品化させるお手伝いをする Win-Win モデルの推進を心がけています。

省電力



VIA 製品特徴の一つとしては、1ワットあたりのパフォーマンスの高さ。ハイパフォーマンスな製品を導入したところで、それが本当に必要とするスペックでなければ、無駄にコストをかける及び電力を消費するだけです。VIA は、お客様のアプリケーションに必要なパフォーマンスに合わせて、低消費電力（TCO 削減）の製品をご提案することができます。選択肢がないからと、不必要にハイパフォーマンスな製品を導入されることはありません。

単一窓口



ハードウェアの問題だけでなく、ドライバやファームウェアのようなミドルウェアやファームウェアの問題も VIA 一社で解決できます。窓口を一本化していることも、VIA のソリューションが選ばれるひとつの理由です。共同開発のパートナーとして、部品レベルの開発から BIOS、ドライバなどのソースレベルのサポートまでを一貫して行うため、お客様の安心感が違います。また、当社は Linux 系にも強く、他社では対象外となる Linux もきちんとサポートします。

VIA のサービス & サポート



ハードウェアとミドルウェアを自社開発しているのが VIA の強みです。そのメリットは、ハードからソフトまで、お客様の要望に合わせて自在にカスタマイズできます。また、システムの根幹から理解しているメリットは、トラブル発生時のサポートにも活かされています。部品を寄せ集めた他社のソリューションでは困難な、本当の意味での問題解決ができるのも VIA ならではです。

VIA 組込み ARM ソリューション

x86 系の開発技術を ARM 製品に活かす

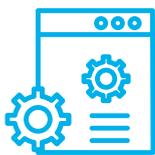


VIA は ARM テクノロジーを採用

VIA は一貫した製品開発コンセプト「省電力」、「省スペース」、「高コストパフォーマンス」に基づいて、x86 テクノロジーの他に、ARM テクノロジーも採用することになりました。ARM テクノロジーは電力効率に優れた上に、処理能力も大幅に進化し、様々な分野に急速に拡大していることで注目を浴びています。



VIA 組込み ARM ソリューションが選択される理由



ミドルウェア開発能力

VIA は、一般的なボードメーカーと異なる強みがあります。これは、CPU、チップセットメーカーであり、グラフィックチップも開発していたデバイスメーカーのノウハウから、OS とアプリケーションを橋渡しするミドルウェアのカスタマイズ、開発を得意としています。開発者はアプリケーションの開発に専念して頂けます。

開発時間の短縮



長期安定供給

VIA は顧客に対する持続的なコミットメントとして、ARM 製品に関する 7 年以上の製品寿命のサポートを提供致します。製品の長期安定供給によって、顧客が頻繁にモデルチェンジする必要なく、TCO (Total Cost of Ownership) の削減にも繋がります。

TCO の削減

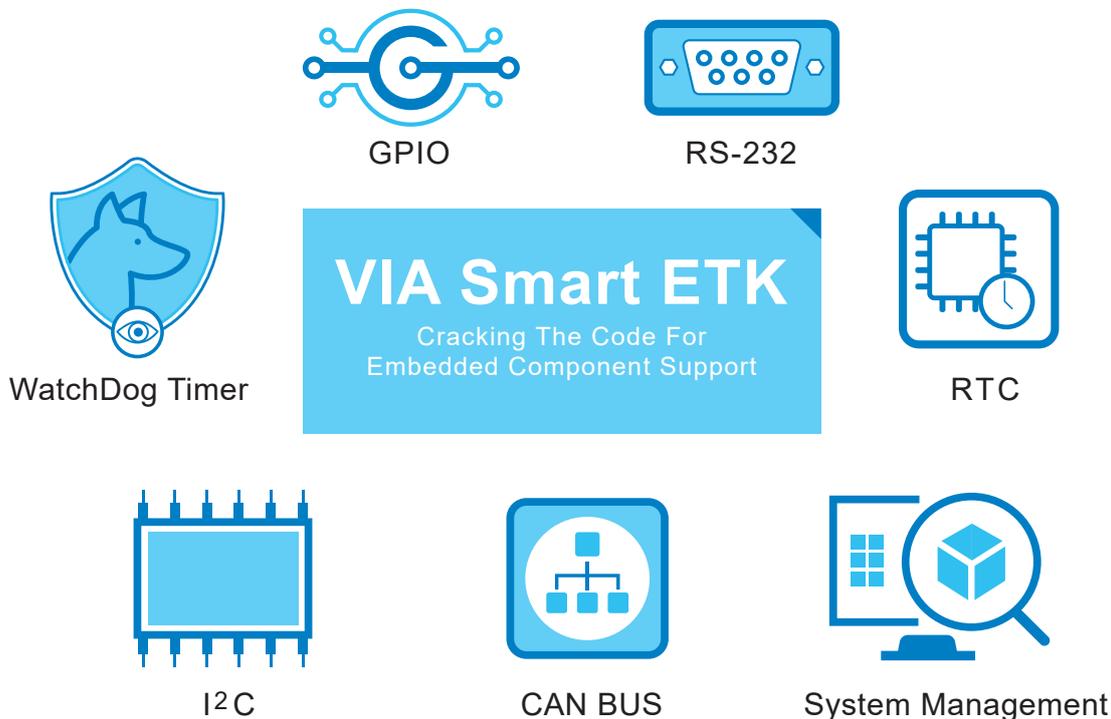


産業用レベル高品質

VIA 製品は全て厳格な QA 体制に基づいて製造されています。ボードデザインの段階から製造まで産業用レベルの使用環境に耐えられる信頼性テストを行っているため、厳しい環境でも安心して使用していただけます。量産後も継続的に品質監視システムがあるため、継続的に高品質を維持することができます。

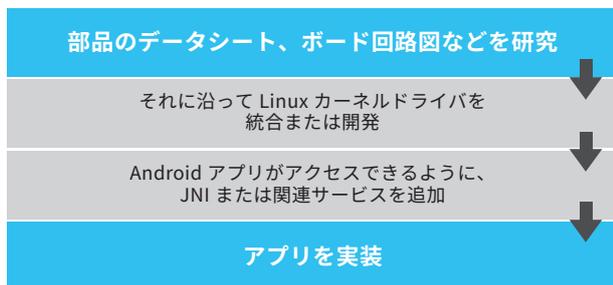
厳格な品質管理

VIA 組み込み向け Android 開発用ツール ～ Smart ETK



Android は、その安定した長期のアプリケーション開発フレームワーク、広範囲な開発者リソース、高性能のネイティブ・マルチメディア機能、親しみやすいユーザーインターフェース、カスタム化性能、市場までの時間とコストの削減といった特徴を利用して、画期的な新しい組み込みシステムと装置の開発を可能にする、心を躍らせる能力を秘めています。

I/O へアクセスする一般的な方法



Smart ETK があれば



Smart ETK がないと

1. 周辺装置向けのドライバの開発や調整が必要
2. Android BSP の調整が必要
3. ソフトウェアとハードウェアの統合が困難



Smart ETK があれば

1. アプリケーションが API を正確に使用することによって、簡単かつ便利に周辺装置を制御することができる
2. 開発資源の投入を抑え、製品信頼性を高める

Smart ETK を使用するメリット

独自の Android 開発ツール



ウォッチドッグ

これは、適切な動作を確実にし、アプリケーション / システムが停止サイクルまたは故障から復帰するのを助けるタイマーをユーザーが設定できる API を提供します。これが設定されると、「ドッグタイマー無効」信号が受信されない場合、システムは自動的に再起動します。



RTC ウェイクアップ

これは、リモートタイムクロック (RTC) 自動ウェイクアップタイマーを設定することによって、自動電源オン機能を提供します。この RTC は、以下の 3 つの自動ウェイクアップモードをサポートします。

- 毎日指定された時刻にウェイクアップ
- 毎週指定された日時にウェイクアップ
- 毎月指定された日時にウェイクアップ



システム電源オフ / 再起動

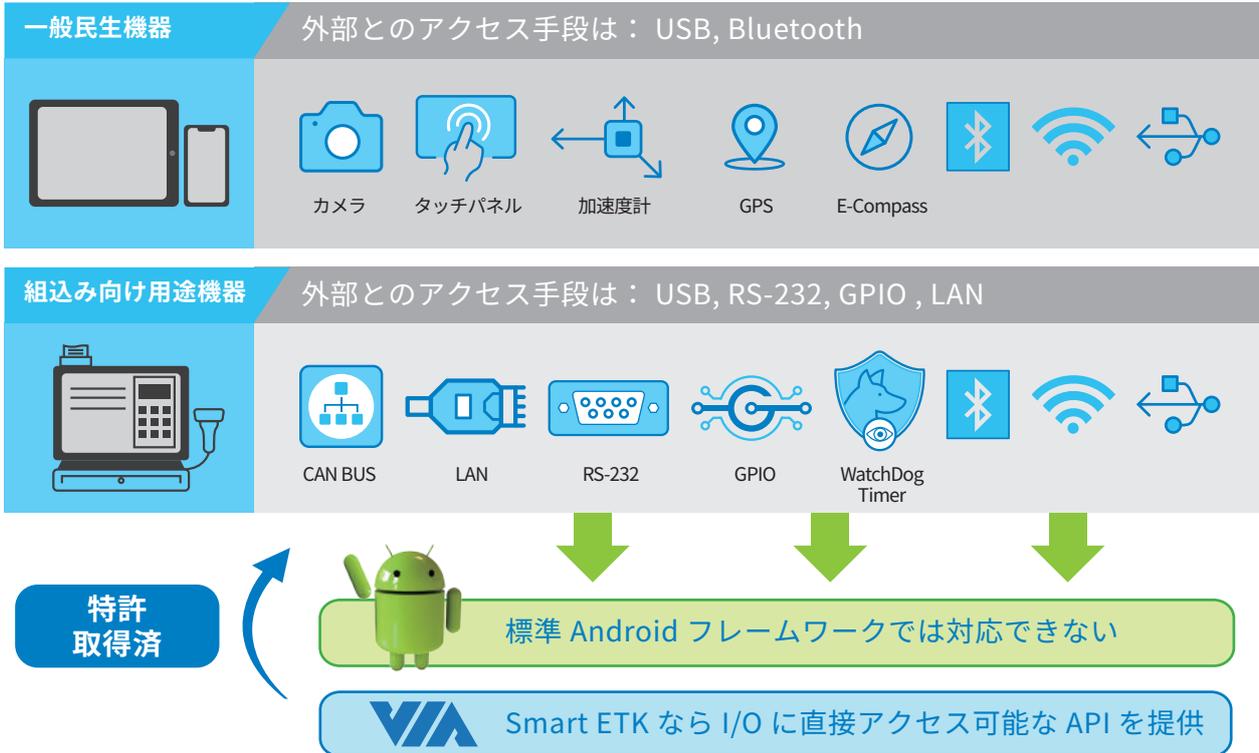
これは、ユーザーが Android アプリケーションを使って、システム電源オフのスケジュールや、最大のパフォーマンスが確実に維持されるように定期的な再起動を設定できるようにする API を提供します。



レガシー I/O サポート

Smart ETK は、アプリケーションにおいて、RS-232、GPIO、I²C および CAN バスポートといったレガシー I/O サポートを可能にします。

VIA Smart ETK には、Android アプリケーションが I/O にアクセスするのを可能にする一連の API および Android フレームワークでサポートされないシステムハードウェアによって提供される管理機能サービスが含まれます。これらの API により、システムのクラッシュ防止のサポート、電源オン・オフのスケジュール機能、ならびに最大のパフォーマンスを確実にする、定期的なシステム再起動が提供されます。



VIA Edge AI Solution

すぐに見える VIA のエッジ AI 標準ソリューションとカスタムソリューション

STANDARD

VIA Edge AI "Ready to Go"

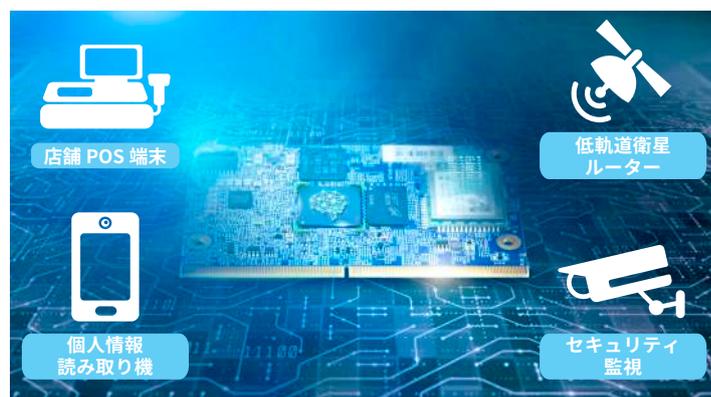
いち早く市場に導入可能

世界はソフトウェア 1.0 からソフトウェア 2.0 へと進化し、アプリケーションとアクティビティは、ますますソフトウェア定義へと進化しています。また CPU アーキテクチャも、PC エコシステムからスマートフォンエコシステムへと進化しており、サプライチェーンの経済性やソフトウェア開発も ARM エコシステムに移行しています。

そこで VIA では、いち早く市場に導入ができるスタンダードなソリューション VIA Edge AI "Ready to Go" と、オリジナル性を持ったカスタムなソリューション VIA Edge AI "Custom" を用意しました。

VIA Edge AI "Ready to Go"

VIA には、すぐに使うことができ、いち早く量産化して市場へ投入ができるスタンダードな Edge AI 製品として、VIA Mobile360 ソリューションと AI/IoT ソリューションがあります。



AI/IoT 標準品 (プラットフォーム)

VIA Edge AI "Ready to Go" ソリューションである Edge AI 製品には、ARM 社の SoC を活用する AI と IoT を組み合わせた AI/IoT プラットフォームが活用されています。VIA の SOM は、製品検査、音声認識、セキュリティ監視に応用する製品があります。



VIA Mobile360 標準品 (車載ソリューション)

車載ソリューションである VIA Mobile360 は、VIA Edge AI "Ready to Go" に属するスタンダードな Edge AI 製品です。顧客がソフトウェアさえ開発すれば、すぐに量産でき、いち早く市場に導入できる Edge AI 製品です。VIA Mobile360 は最も要求の厳しい舗装路およびオフロード環境向けに設計されており、車両の安全性と効率を高めま。

VIA Edge AI "Custom" オリジナル性

CUSTOM

VIA Edge AI "Custom"

VIA では、いち早く市場への導入が可能な Edge AI のスタンダード製品のほか、用途ごとにオリジナルなカスタム設計ができる VIA Edge AI "Custom" の設計・開発も行っています。

VIA Edge AI "Custom" は、VIA Edge AI "Ready to Go" の標準ソリューションにオリジナルなカスタム設計を行い、様々な分野に展開できる製品を提供します。設計から生産まで、VIA の確実な検証、制御、フローのもと、顧客のご要望に応じた VIA Edge AI カスタム製品を製造します。



VIA では、製品ニーズに対して迅速な対応を行うために、熱や気流、機械 3D、信号品質、無線周波数に関するシミュレーションができる試験設備のほか、環境試験設備や電気試験設備も備えています。



VIA は、すぐに使うことができ、いち早く量産化して市場へ投入ができるスタンダードな Edge AI 製品 VIA Edge AI "Ready to Go" と、用途ごとに顧客オリジナルなカスタム設計ができる VIA Edge AI "Custom" の両方に対応しています

AI/IoT 向けプラットフォーム

MediaTek Genio シリーズ及び NVIDIA Jetson Orin シリーズソリューション

VIA 製品を導入するメリット

SoC 設計の専門知識

VIA は一般のボードメーカーと違って、ARM の SoC を自社開発ができる技術力を持つ半導体メーカーでもあります。x86 系製品から累積してきた経験及びノウハウを ARM 製品に生かし、信頼性の高い組み込み製品を長期安定供給を目指します

豊富なソフトウェア開発フレームワーク

VIA は組み込み向け Android に特許を取得した「SmartETK」という開発ツールを提供しています。SmartETK には、Android アプリケーションが I/O アクセスするのを可能にする一連の API 及び Android フレームワークでサポートされないシステムハードウェアによって提供される管理機能サービスが含まれます。また、AI アプリケーション向けに Android Neural Networks API へのサポートやサンプルコードの提供によって AI アプリケーション開発者がより開発しやすい環境を整えます。

市場投入までの時間短縮

SOM(System-On-Module) とは、SoC、メモリ、電源管理、通信コンポーネントなど、コンピュータの基本機能を凝縮したモジュールです。お客様は SoC 周りの設計を行う必要がないため、開発期間の短縮、開発費用の低減、市場投入までの時間短縮が可能です。SOM 製品以外に、すぐ使用できる SBC(Single-Board-Computer) 製品やシャーシが付いているシステム製品を需要に応じて製品ラインナップを展開しています。



VIA AI/IoT 製品ラインナップは SOM(System-On-Module) 製品からシャーシ付きのシステム製品まで幅広く製品ラインナップをそろえています。SoC はエントリーモデルからハイエンドモデルまで、組み込み用途向けの MediaTek 製 Genio シリーズおよび NVIDIA Jetson Orin シリーズから選択可能であり、組み込み分野に求められる長期安定供給にも対応しております。Genio シリーズにはすべて AI 専用エンジン (APU) が搭載されており、Jetson Orin シリーズには高性能な GPU が搭載されているため、AI アプリケーションを最大限に活用することが可能です。



Edge AI 向けの製品ラインナップ

AIトレンドと活用

近年技術の進化によって AI アプリケーションは様々な産業に活用されています。使用シーンによってクラウド AI とエッジ AI がそれぞれ重要な働きをしています。特にエッジ AI は操作している端末内で推論を行うため、利用者が求める判断をすばやくアウトプットすることができるため注目が浴びています。

製造業・工業生産



- ・機械の故障を予測・告知
- ・機械の異常を検出
- ・ベルトコンベヤーに流れている商品の不良品を検出・排除

交通



- ・先進運転支援 (ADAS)
- ・ドライバー安全システム支援 (DSS)
- ・ナンバープレートの自動検出

教育



- ・校庭の自動監視
- ・生徒の行動や表情をトラッキング
- ・教師の説明をリアルタイム文字化

小売業



- ・万引検知
- ・顧客の店舗内の行動パターン分析
- ・セキュリティ支援

AI 向け開発ツール及び評価キット

VIA AI/IoT 製品は MediaTek 製 Genio シリーズを採用し、全シリーズに AI 専用計算エンジン (APU) が搭載されているため、エントリーの AI からハイエンド AI まで幅広く対応できます。AI 開発ツール MTK NeuroPilot SDK を使用することによって、AI 処理を自動的に APU や GPU、CPU に振り分けることができますので、AI パフォーマンスを最大限に発揮することが可能です。VIA の AI/IoT 評価キットでいち早く POC を開発することができます。

NeuroPilot Machine Learning Kit Tool

- モデルの変換
- モデルの評価・最適化
- モデルの暗号化

Tool

TensorFlow

TensorFlow Lite

Caffe

PyTorch

others

Application

Android Neural Networks API 

MTK NeuroPilot Library  

SDK

NeuroPilot Heterogeneous Runtime

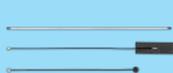
BSP

GPU

CPU

APU

SoC



評価キット

クロスプラットフォーム AI の最適解

NVIDIA TAO × MediaTek : スムーズなモデル統合と移行の実現



AI 技術の進歩に伴い、当社は NVIDIA 社の Jetson Orin シリーズを活用し、AMR・AGV・物体認識・スマートインダストリーなどの分野をターゲットとした高性能ソリューション展開を加速。

NVIDIA TAO Toolkit × VIA の MediaTek 製品で誰でも簡単に



VIA の製品群は「NVIDIA TAO Toolkit」に対応しており、専門知識がなくても高性能な AI アプリケーションを構築できます。100 種類以上の事前学習済みモデルや 25 種類以上のタスク別モデルが用意されており、短時間で開発が可能です。生成 AI も含まれています。



NVIDIA TAO Toolkit の AI モデルはすべて事前学習済みで、そのまま使用可能です。少量の固有データを加えることで転移学習による最適化も可能で、効率的に用途に合った AI を構築できます。独自の事前学習済みモデルも活用できます。



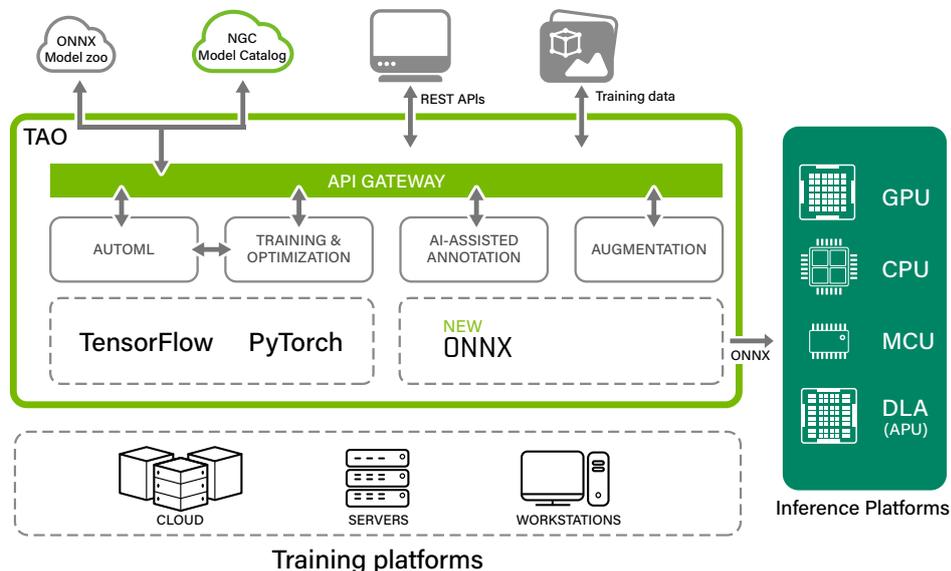
生成した AI アプリケーションは、AMOS-9000 や AMOS-9100 向けに最適化可能です。また、VAB-5000 などの製品でも、MediaTek Neuro Pilot SDK と TAO Toolkit の連携により、MediaTek 製 SoC 向けの最適化が実現できます。これにより、全プラットフォームで高いコストパフォーマンスを発揮します。

AI 開発から評価まで最短ルート : TAO モデル活用フロー



特徴：高い移植性と移行の容易さ

クロスプラットフォーム対応
柔軟な SDK とツールセット
エッジデバイスへの最適化
→ 短期間での導入が可能
→ 既存資産の有効活用



MediaTek および NVIDIA 製品における AI パフォーマンスの比較分析

本検証では、VAB-5000 と AMOS-9100 にて、同一の AI モデル（1440p 動画）を使用してフレーム毎の物体検出を行い、AI 推論を実行した結果をご紹介します。

人物が大きく映り込んでおり物体検出のしやすい動画に対する推論：

使用した動画は人物が正面から大きく映っており、物体検出がしやすい構成となっていますが、いずれのプラットフォームでも、検出精度はほぼ同等であり、実用上十分なパフォーマンスを発揮していることが判明しました。



ローアングルの視点によって、人物の物体検出が困難になる動画に対する推論

この動画では、ローアングルの視点や人混みの影響によって、人物の検出が困難になり、より高度な認識能力が求められます。いずれも 28 ~ 30fps の速度で推論が可能。ただし、AMOS-9100 の方がより多くの人物を検出できる結果となりました。



AMOS-9100 に近い精度を実現するため、VAB-5000 では以下のような手法を試しました。TensorFlow 形式から TensorFlow Lite 形式への変換時に最適化を抑制。高精度な演算のみを使用し、AI モデル構築結果として、より多くの人物が検出可能となりました。



用途に応じた AI モデルの最適化及び、製品の選定について、VIA は柔軟な対応が可能です。

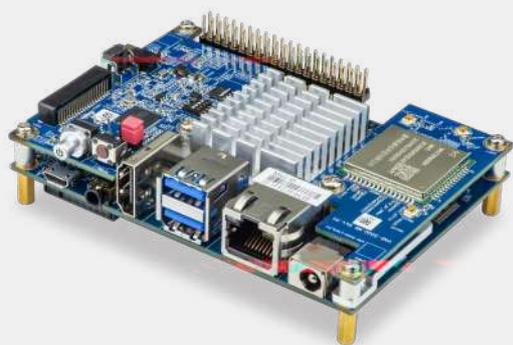
エッジ AI 特化型ソリューション

Pico-ITX フォームファクターのコンパクトなシングルボードコンピュータ

VAB-5000

Pico-ITX フォームファクターのコンパクトなシングルボードコンピュータ

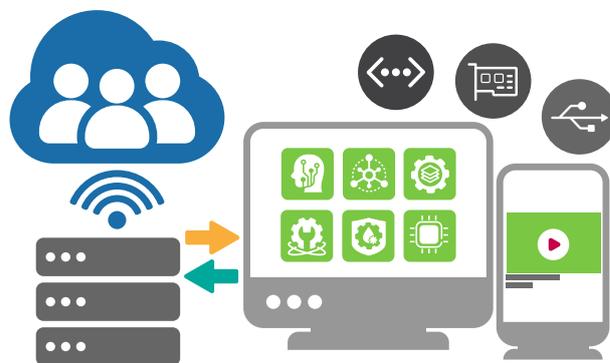
Edge AI に最も適した市場を考え、必要な機能を備えたシングルボードコンピュータの設計から生まれた VAB-5000。スクリーンやカメラに対応し、幅広い接続性能とインターフェースを備えることで高度な Edge AI システムを生み出すほか、新たなデバイスの開発を加速させます。



ハードウェアには、「ビッグコア」である Arm Cortex-A78 CPU × 2 と「高効率コア」である Cortex-A55 CPU × 6 を搭載するオクタコア CPU の MediaTek Genio 700 を採用しています。この SoC は 6nm プロセスを実現し、低消費電力とマルチタスク OS に最適な高パフォーマンスを実現します。



VAB-5000 に搭載している、TOPS 4.0 の計算力を持つ AI カメラ向け高性能 AI エンジンシステムは、下記のようなカメラおよび映像向けのアプリケーションに適用できます。



VAB-5000 には複数のカメラおよびディスプレイを接続可能です。幅広い接続性とインターフェースを備えており、高速バス PCIe(PCI-Express)、USB 3.1、GbE(ギガビットイーサネット)および 4K など、最新のマルチメディア規格および 4K マルチディスプレイに対応します。

AI エンジン搭載ゲートウェイ

ARTIGO A5000 システムは、ハイパフォーマンスな MediaTek Genio 700 オクタコア SoC と豊富な I/O 機能や接続機能を組み合わせた、コンパクトで耐久性に優れたファンレスシステムです。



アンテナを内蔵しているので、設置が簡単で見た目もすっきりしています。筐体もコンパクトサイズなので、場所を選ばずに設置することができます。

PCI-Express 3.0/2.0、USB 3.1、GbE（ギガビットイーサネット）、MAC など、さまざまな高速インターフェースを使用できます。



SOM(System-On-Module) とは、SoC、メモリ、電源管理、通信コンポーネントなど、コンピュータの基本機能を凝縮したモジュールです。お客様は SoC 周りの設計を行う必要がないため、開発期間の短縮、開発費用の低減、市場投入までの時間短縮が可能です。SOM 製品以外に、すぐ使用できる SBC(Single-Board-Computer) 製品やシャーシが付いているシステム製品を需要に応じて製品ラインナップを展開しています。

次世代産業向け AI ソリューション

NVIDIA Jetson Orin シリーズソリューション



AI 技術の進化に伴い、当社は Jetson Orin NX および Orin シリーズを活用し、AMR・AGV・物体認識などの分野で環境認識や自動化を支援し、スマートインダストリーや高性能 AI ソリューションの実現を加速します。



AMOS-9000 省電力且つ高い AI 処理能力

NVIDIA Jetson Orin Nano プロセッサを搭載し、最大 40TOPS の AI パフォーマンスを提供。デュアルギガビットイーサネット、COM ポートを備え、マシンビジョンカメラやセンサーとシームレスに統合可能。軽量のファンレス設計で、リアルタイムの欠陥検出や品質管理を実現。

AMOS-9100 ロボティクス・自動化に最適

NVIDIA Jetson Orin NX プロセッサを搭載し、最大 70 TOPS の AI パフォーマンスを実現。NVIDIA JetPack SDK に対応し、ディープラーニングモデルのスムーズなデプロイを支援。LoRa 接続機能を統合し、遠距離かつ低消費電力の安定した通信を確保。デュアルギガビットイーサネット、PoE 対応、広温度範囲での動作により、産業タスク処理が可能。



インテリジェントオートメーション：ロボット工学の新時代



AMR（自律移動ロボット） リアルタイム AI でスムーズな走行

従来の AMR は障害物に遭遇すると停止し、人間の介入が必要でした。しかし、リアルタイム AI 処理機能を搭載することで、「自ら考えながら走行できる」ロボットへと進化しました。センサーやカメラからのデータを分析し、障害物をスムーズに回避。ルートを自動的に再設定し、業務の遅延を解消し、全体の生産性が大幅に向上できると考えます。



AGV（無人搬送車） 温度変化に強い高耐久システム

AGV も大きな進化を遂げ、温度変化の激しい環境でも安定したパフォーマンスを発揮できるようになりました。従来は温度管理されたゾーン間を移動する際に停止することが多かったが、新システムではスムーズな移動が可能に、施設内の物流が途切れることなく進行し、業務の効率が向上します。



NVIDIA の Jetson Orin シリーズを活用したエッジ AI ソリューションは、産業のスマート化を加速し、ロボティクス・自動化の新たな可能性を切り開きます。当社の産業用コンピュータと統合することで、より高度な AI 推論、リアルタイム画像処理、効率的なエッジコンピューティングを実現します。

未来の産業を支える次世代技術に、ぜひご期待ください。

MaaS 向けソリューション

ドライブレコーダー型車両管理向けシステム



VIA Mobile360 D800 AI ドライブ レコーダー



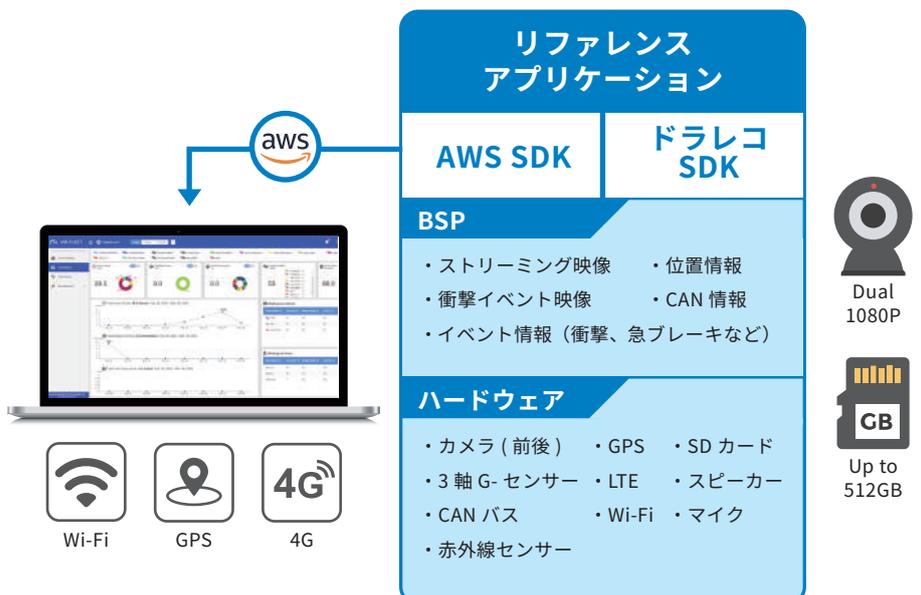
D800 に MaaS 向けに必要なとされるハードウェア機能及びソフトウェア機能を一つのパッケージとして提供します。標準の D800 を使用することによって簡単に貴社のオリジナル製品・サービスに導入することができるほか、個々の動作シナリオに合わせてリファレンスアプリをカスタマイズすることも可能です。

豊富なハードウェア機能

フロントカメラ・リアカメラ、二つのカメラが実装されたため、車両内外の状況を把握できるほか、赤外線センサーを搭載されていますので、高品質の夜間録画が可能です。また、GPS、G センサ、車速パルスにより、位置、衝撃、速度など、車両情報を全般的に取得することができます。

様々な通信手段

技適取得済みの LTE や Wi-Fi モジュールを搭載していますので、いつでも、どこでも、端末デバイスやクラウド経由で、即時に車両の状態を確認することができます。



D800 ソリューションを導入するメリット



車両監視



走行車両
情報の記録



運転習慣の改善



運営費用の検討

すぐ動作可能なリファレンスアプリケーション付属

付属のリファレンスアプリケーションによって、ドライブ映像の常時録画やイベント情報の記録など、ドライブレコーダーに求められる機能を装備したほか、車両情報をクラウドへの送信や走行情報の分析なども行えます。

ドラレコ SDK

ドライブレコーダーのソフト開発に必要な API を提供します。短期間でオリジナルアプリケーションを開発することが可能となります。

AWS SDK

クラウド市場の中で最も利用されている AWS の IoT Core と Kinesis Video Streams(KVS) サービスに特化した SDK を提供します。VIA AWS SDK を通して、簡単に車両情報をクラウドに伝送し、幅広い業務を展開できます。

スペック

Front Panel I/O



Rear Panel I/O



Right Panel I/O



Bottom Panel I/O



リファレンス Web ダッシュボード

クラウド上で、車両の監視、情報の収集、車両の管理を行います。



常時車両追跡

- 地図位置
- 車両情報 (速度など)
- 動画ストリーミング
- 音声で運転手との連絡

ダッシュボード

- ガソリン消費
- フリート評価
- イベント発生数の統計

履歴記録

- 各車両走行ルート記録
- イベント発生記録

車両管理

- 各車両の情報管理

リファレンス携帯アプリ

クラウド上で、車両の監視、情報の収集、車両の管理を行います。



ライブストリーミング

- ライブ音声と画面

アルバム

- 常時録画
- 衝撃検知前後 10 秒の映像を自動で記録

走行ルート記録

- 各車両の走行ルートの管理を簡単に

イベント統計

- 急ブレーキ、急発進の統計管理

AI フォークリフト安全システム

前方・後方人物検知機能付き、「ドライバーセーフティシステム」がドライバーと現場の安全を守る



VIA Mobile360 フォークリフト 安全システム



信頼性の高い ISO 16750-3 VII、IP67 防水防塵認証により、幅広い現場へ対応できます。多彩な各種パッケージを用意しており、最大3台の歩行者検出カメラ、ドライバーカメラ、アラート用の高品質スピーカーを搭載。多種多様な I/O サポートが可能、7インチディスプレイや車速及びバックセンサーの追加オプション有り。

オペレーター行動

DSS（ドライバー安全システム）搭載し、運転中の安全のため、ドライバーカメラを通して、疲労、喫煙、携帯電話の使用を検出するたびにアラートを出します。

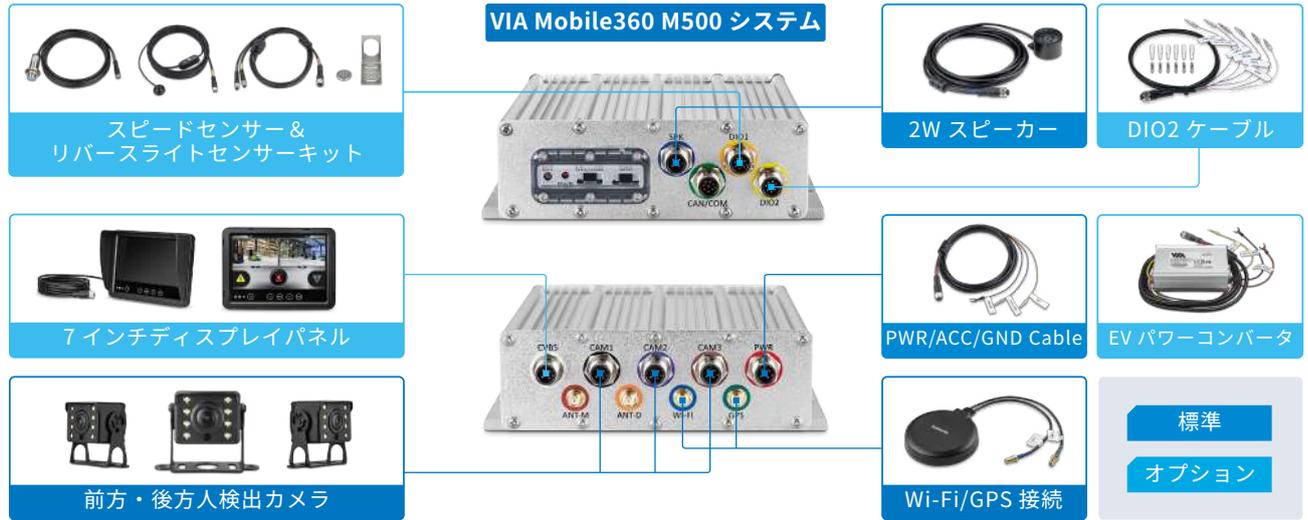


豊富な視覚認識

オプションの7インチ CVBS モニター、使いやすいインターフェースを搭載し、最大3台のカメラの画像をストリーミングし、ドライバーに簡単に認識させることができます。



システム構成

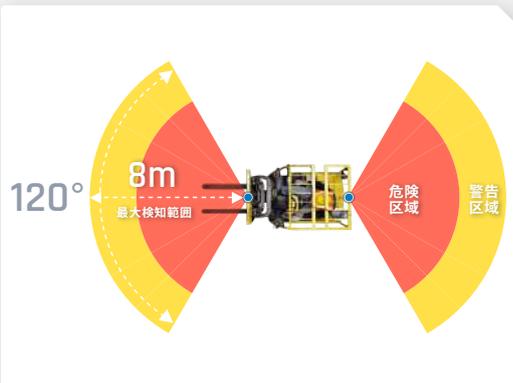


人検出

オプションの 7 インチ CVBS モニター、使いやすいインターフェースを搭載し、最大 3 台のカメラの画像をストリーミングし、ドライバーに簡単に認識させることができます。

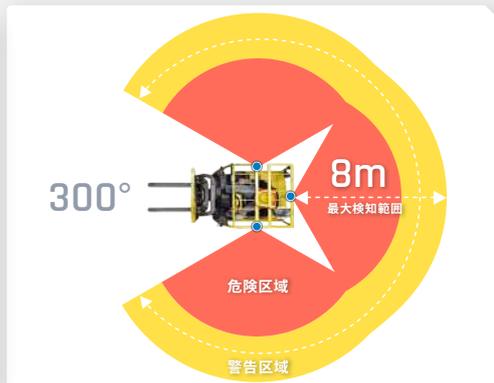
2PD Package

2 Camera Pedestrian Detection



3PD Package

3 Camera Pedestrian Detection



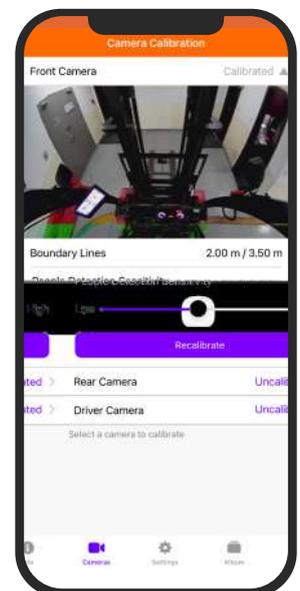
VIA WorkX Connect App

VIA WorkX Connect App のスマートフォンアプリを通して、最大 3 台のカメラの校正やシステムの設定、そしてシステムの Micro SD カードに保存されているビデオの表示とダウンロードが可能です *

アプリ対応 OS

- Android 5.0 以降
- iOS 12 以降

* ファームウェアを更新して頂く場合があります



生成 AI は「クラウド」から「エッジ」へ

MediaTek Genio 520 が実現する、サーバーレス&リアルタイムな「オンデバイス LLM」の実装

SOM-5200 で開発する：「言葉の壁」を超えるインテリジェント・キオスク

「インバウンド需要の増加や人手不足に対し、クラウドに依存しない『エッジ AI』が解決策となります。VIA は、MediaTek Genio 520 を搭載したモジュール『SOM-5200』および『OSM-5200』を提供。これらのハードウェアが高い NPU 性能を発揮し、インターネット接続不要で動作する『多言語対話システム』の開発を可能にします。」

タッチレス&ボーダーレスな「Voice-to-Voice」体験の実装

SOM-5200 の演算能力を活用すれば、従来のタッチパネル操作を必要としない直感的な UI が構築可能です。軽量 LLM (SLM) と音声認識モデル (SenseVoice) を組み合わせることで、ユーザーが母国語で話しかけるだけで意図を理解するコンシェルジュ端末を開発できます。クラウドへの送信待機時間 (レイテンシ) がないため、まるで人と話しているようなスムーズな応答速度を、御社の製品に付加することができます。



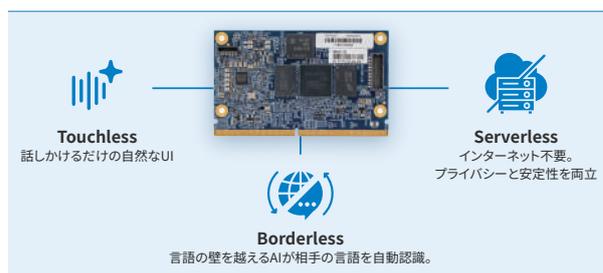
言語選択もタッチ操作も不要。話しかけるだけで AI が意図を理解することが可能に。

開発メリットと効果

- ・ **開発の柔軟性** : SOM (System on Module) 形式のため、キオスク、サイネージ、サービスロボットなど多様な筐体に組み込み可能。
- ・ **多言語対応** : 英語、中国語、日本語など、インバウンド顧客への対応を自動化。
- ・ **プライバシー保護** : 音声データを外部に出さないため、医療や公共機関向け端末にも最適。

「ホスピタリティが求められる、リテール・観光の最前線へ」

「SOM-5200」を採用することで、通信遅延のない即座の応答が可能になります。顧客をお待たせしない「遅延ゼロ」の体験こそが、次世代端末の必須条件です。



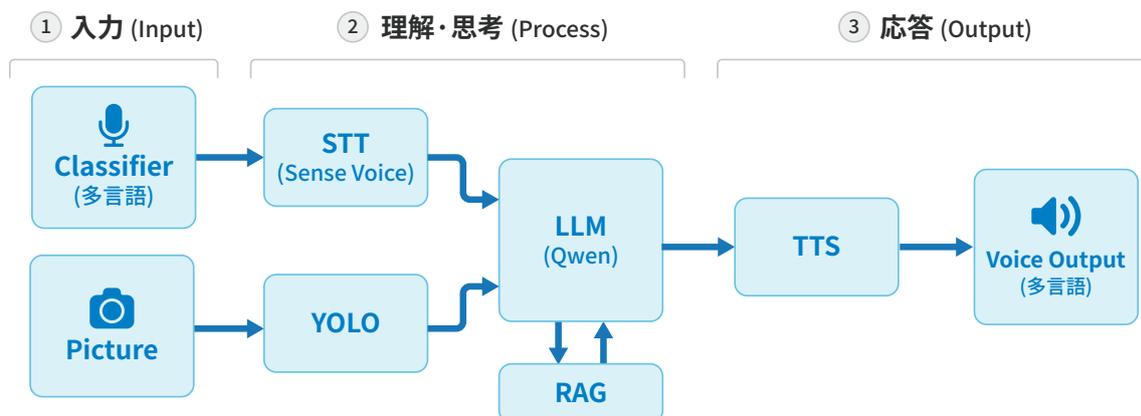
言葉の壁を超える対話型ソリューション

SOM-5200 で構築する：専門知識を持つ「RAG」システム

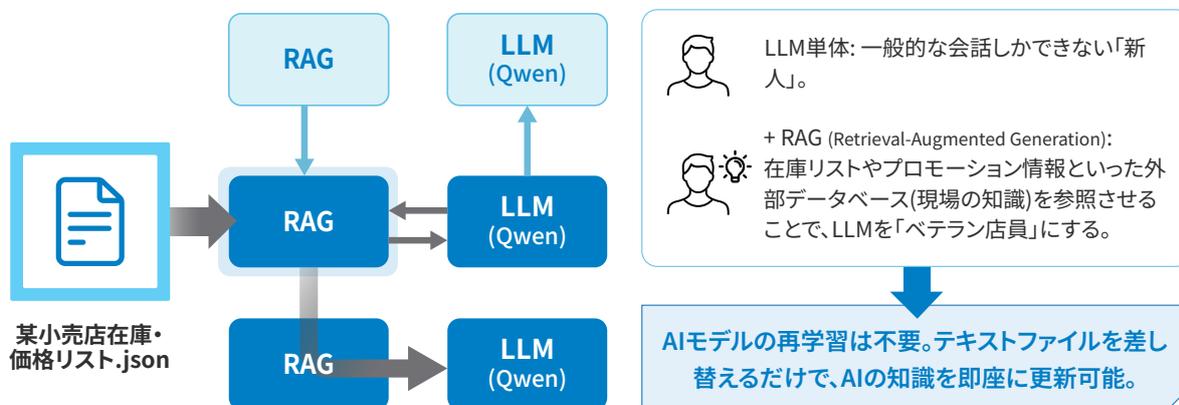
汎用的な LLM を製品に組み込むだけでは、実用的な業務対応はできません。製品や施設に固有の「専門知識」を統合するアーキテクチャが必要です。

RAG 技術と MDLA による「高速・軽量・低コスト」なシステム設計

SOM-5200 は、量産機器への組み込みに最適です。本特集のデモでは、外部データベースを参照して回答を生成する「RAG (Retrieval-Augmented Generation)」技術を実装しました。Genio 520 内蔵の AI アクセラレータ「MDLA」が推論を高速処理し、CPU 負荷を低減。在庫データやマニュアル等のテキストファイルをローカルに置くだけで、再学習なしに AI の知識を更新できるシステムを、低消費電力かつ低コストで構築できます。



専門知識を教える：RAG で「現場のプロ」に進化



なぜクラウドではなく、G520 エッジ AI なのか？

	G520 Edge AI	Cloud AI
高速レスポンス (Low Latency)	通信遅延ゼロ。MDLA による高速推論で、自然な会話テンポを実現。	ネットワーク遅延が避けられない。
プライバシー保護 (Security & Privacy)	音声も映像もデバイスから出ない。個人情報扱われる場面でも安心。	データ送信によるプライバシーリスク。
コスト削減 (Cost Efficiency)	クラウド LLM の API 利用料 (トークン課金) ゼロ。通信費ゼロ。	継続的な API コストとデータ通信費が発生。
オフライン稼働 (Reliability)	ネット環境がない場所や、災害時でも安定稼働。	ネット接続が必須。通信障害で停止。

「運用コストと安定性が重視される、量産製品の開発へ」

膨大な維持費がかかるクラウド AI に対し、SOM-5200 を用いた「オンデバイス LLM」なら、ランニングコストをゼロに抑えた競争力ある製品設計が可能です

エッジ AI による「外観検査・異常検知」の実装戦略

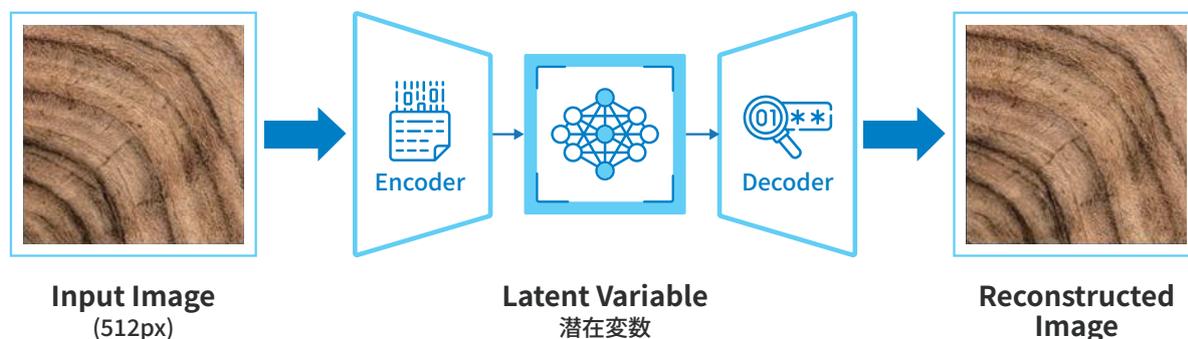
AMOS-9100 と VAB-5000 で実現する、用途に応じたアーキテクチャ選定の最適解

製造業の DX において、AI による「異常検知」は品質向上とコスト削減を両立する核心技術です。VIA は、NVIDIA Jetson Orin NX 搭載のハイエンドシステム「AMOS-9100」と、MediaTek Genio 700 搭載のメインストリーム SBC「VAB-5000」の2つのプラットフォームを展開。本特集では、オートエンコーダ技術を用いた2つの異なるアプローチと、それぞれのハードウェア特性を最大限に引き出す実装手法を解説します。

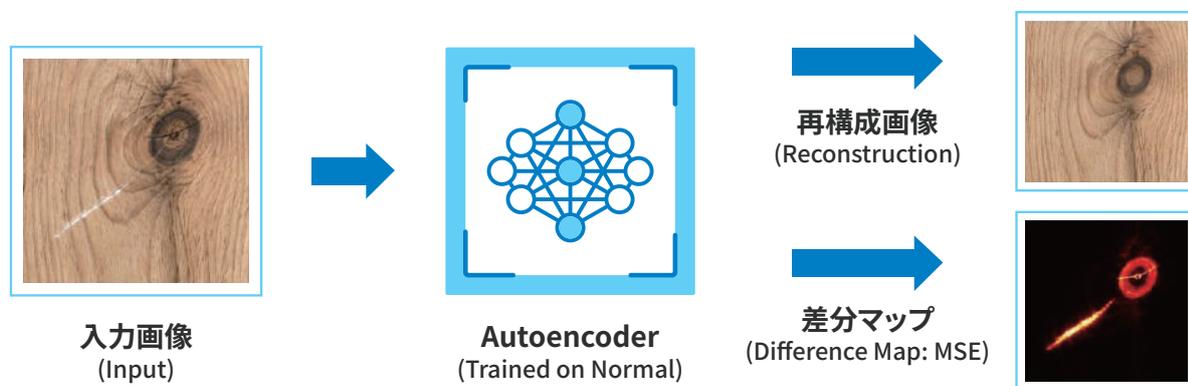
ハイエンド AI 戦略 / AMOS-9100：精度重視の「再構成誤差」アプローチ

GPU をフル活用した「再構成誤差」方式

AMOS-9100 は、強力な CUDA コアを活かした「再構成誤差 (MSE)」方式を採用します。正常画像のみを学習した「オートエンコーダ」に検査画像を入力し、AI が復元を試みます。異常箇所は正常な状態に補正されて出力されるため、元の画像との間に大きな差分が生じます。この差分を評価することで、目視困難な傷も正確に特定できます。不良品の見逃し (False Negative) を許さない厳格な最終検査に最適です。



入力データを圧縮し、再構成する過程で「正常なパターン」のみを学習する (非教師あり学習)

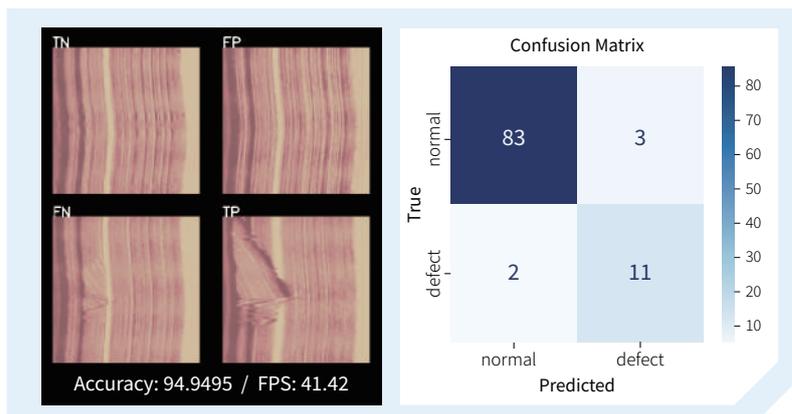


正常画像のみで学習したモデルは、異常箇所を再構成できない。この「入力と出力の差」を異常として検知する

精度：94.9495 FPS：41.42

「精度が最優先される、最終検品ラインの自動化へ」

高付加価値製品の品質保証には、GPU の表現力を活かした AMOS-9100 が、揺るぎない産業競争力を提供します。

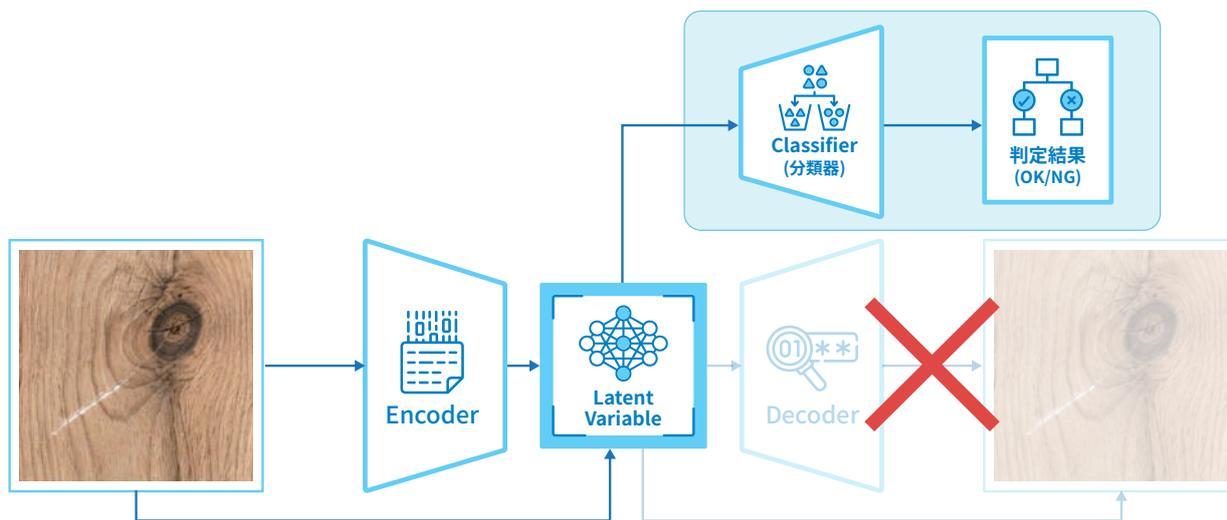


エッジデバイスに求められるのは精度だけではなく、膨大な生産量を誇るラインでは、低消費電力かつ圧倒的な処理スピードが求められます。

メインストリーム AI 戦略 / VAB-5000 : 「速度」を極める潜在変数分類アプローチ

NPU (MDLA) による「潜在変数分類」方式

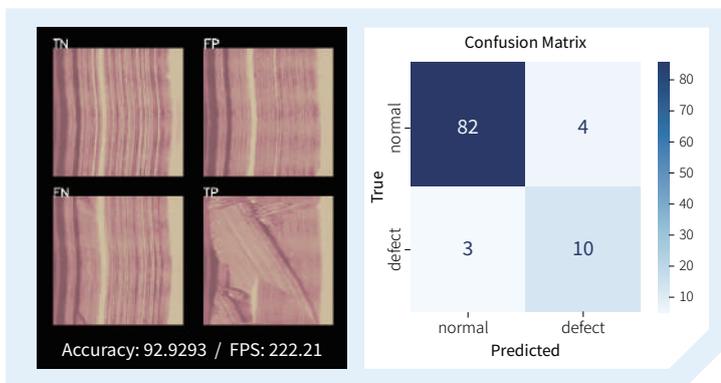
VAB-5000 は、AI 専用アクセラレータ「MDLA」の特性に合わせ、処理の重いデコーダ（画像復元）を省いた「潜在変数+分類器」方式を採用します。エンコーダが抽出した特徴量（潜在変数）の分布から異常を瞬時に判定。VIA 独自の Neuron Runtime Helper により、Python ベースで MDLA を直接制御。222fps という驚異的な速度は、瞬時の一次選別に圧倒的な効率をもたらします。



画像の再構成を行わず、圧縮された「潜在変数」を直接分類器にかけて判定する（教師あり学習への変換）

精度：92.9293 FPS：222.21

「速度とコストが鍵となる、一次スクリーニング工程へ」膨大な処理量が求められる前工程の選別には、圧倒的なFPSを誇るVAB-5000が、最高レベルの投資対効果（ROI）が得られます。



現場の制約が技術を選ぶ

「精度」と「速度」か。VISVIAのエッジAIプラットフォームは、お客様の現場の現実に即した最適なシステム構築を支援します。

選定基準	再構成誤差に着目する方式	潜在変数に対して分類器を適用する方式
学習に必要なデータ	正常なデータのみが必要	正常なデータと異常なデータが同数必要
重視する精度	Recall 重視	Precision 重視
想定用途	不良品の見逃しが許されないアプリケーション	大量のデータの中から異常を検出するスクリーニングアプリケーション
適したハードウェアアクセラレータ	GPU	MDLA
演算の負荷	高い (デコーダの処理が大きい)	低い (CNN 相当)

AI/IoT 製品

Qualcomm 搭載・高速通信 12 TOPS 演算 SOM モジュール

SOM-8600



Qualcomm QCS6490	Up to 128GB UFS storage
Up to LPDDR5 8GB	Wifi 6/E + BT5.2



Qualcomm



現在開発中のため、製品仕様は一部変更となる可能性があります。

1 Qualcomm QCS6490 オクタコア SoC 搭載

最大 2.7GHz で動作するプレミアムな Kryo 670 CPU を搭載した高性能オクタコア CPU 及び高度な 3D グラフィックスに対応可能。

2 高性能 AI プロセッサ搭載

専門 AI プロセッサ Qualcomm Hexagon™ 770 を搭載し、最大 12 TOPS の AI 推論を実現。

3 優れたビデオ処理能力

4K@60fps のデコードおよび 4K@30fps のエンコードに対応し、高精細な画像処理が可能。

部品番号	TBD
搭載 SoC	Qualcomm QCS6490 Octa-core Processor (8x Kryo 670 CPU, Max 2.7 GHz)
AI 性能	12 TOPS (Qualcomm Hexagon™ 770)
メモリ	6GB / 8GB LPDDR5 DRAM
ストレージ	64GB / 128GB Universal Flash Storage (UFS)
OS	Android / Linux
I/O	1x 4-lane MIPI DSI, 3x 4-lane MIPI CSI, 1x USB 3.1/2.0 (OTG support), 2x USB 2.0 HOST, 1x PCIe 3.0 (2-lane), Wi-Fi 6/6E, 10x SPI, 16x I2C, 4x UART, 5x I2S, 4x ADC, 2x DMIC, 1x SD 3.0
使用環境	稼働温度: -35°C ~ 75°C 稼働湿度: 0% ~ 95% (結露なきこと)
外形寸法	82mm x 50mm (SMARC)

デュアル ISP・高速演算 LLM 特化型 SOM モジュール

SOM-7200



MediaTek Genio 720	128GB UFS storage
Up to LPDDR5 16GB	GLAN x1



MEDIATEK



現在開発中のため、製品仕様は一部変更となる可能性があります。

1 MediaTek オクタコア Genio 720 SoC 搭載

最大 2.6GHz で動作するプレミアムな Arm Cortex-A78 を搭載した高性能オクタコア CPU 及び高度な 3D グラフィックスに対応可能。

2 LLM のエッジ AI 推論最適化

専用の AI プロセッサ (NPU) と NeuroPilot SDK を統合することで、エッジ環境への LLM デプロイを最適化し、最大 10 TOPS の AI 推論を実現。

3 デュアル ISP による高精細マルチカメラ対応

16MP+16MP@30fps の同時処理が可能し、ステレオビジョンや高度な視覚認識を必要とするハイエンド IoT 機器に最適です。

部品番号	TBD (Preliminary)
搭載 SoC	MediaTek Genio 720 Octo-Core Processor ・Dual-core Cortex-A78 SoC@ Max to 2.6GHz ・Hexa-core Cortex-A55 SoC@ 2.0GHz
AI 性能	10 TOPS (MediaTek NPU 850)
メモリ	8GB / 16GB LPDDR5X
ストレージ	128GB UFS Flash Memory
OS	Android 15, Yocto 5.0, Debian 12
I/O	1x HDMI 2.0, 1x MIPI DSI (4-Lane), 2x MIPI CSI-2 (4-Lane & 2-Lane), 2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0, 1x PCIe Gen3 (1-Lane), 1x GLAN, 1x SDIO, 2x SPI, 4x UART, 4x I2C, 12x GPIO, 2x CAN-FD, 1x I2S
使用環境	稼働温度: 0°C ~ 60°C 稼働湿度: 0% ~ 95% (結露なきこと)
外形寸法	82mm x 50mm (SMARC)

高性能高機能 SOM モジュール

SOM-7000



MediaTek Genio 1200	eMMC 16GB
LPDDR4 8GB	GLAN x1



1 MediaTek Genio 1200 オクタコア SoC 搭載

最大 2.2GHz で動作するプレミアムな 4X Arm Cortex-A78 プロセッサを搭載した高性能オクタコア CPU および高度な 3D グラフィックスに対応可能。

2 高速バス対応

PCI-Express 3.0/2.0 と USB3.1 と GbE と 4K@90Hz 再生などのさまざまな高速インターフェースを使用可能。

3 TOPS4.8 AI エンジン搭載

AI 演算を特化した APU を搭載して TOPS 4.8 の AI パフォーマンス。ハードウェア処理によって低消費電力で高いパフォーマンスを発揮することが可能。

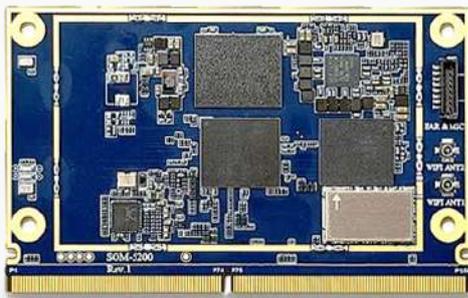
部品番号	10GPZ22M30020
搭載 SoC	MediaTek Genio 1200 Octo-Core Processor ・Quad-core Cortex-A78 SoC@ 2.2GHz ・Quad-core Cortex-A55 SoC@ 2.0GHz
メモリ	8GB LPDDR4 SDRAM
eMMC	16GB
OS	Android 13 / Yocto 4.0 / Debian 12
I/O	2 MIPI DSI, 2 MIPI CSI-2, HDMI, Display Port, USB 3.1, 3 USB 2.0, GLAN, 2 SPI, 2 I2S, 3 I2C, 2 UART, 2 PCIe, SDIO, 4.3V DC-in
使用環境	稼働温度: 0°C~60°C 稼働湿度: 0%~95% @45°C (結露なきこと)
外形寸法	82mm x 80mm

シングルキャプチャ最適化・高能率 SOM モジュール

SOM-5200



MediaTek Genio 520	128GB UFS storage
Up to LPDDR5 16GB	GLAN x1



現在開発中のため、製品仕様は一部変更となる可能性があります。

1 MediaTek オクタコア Genio 520 SoC 搭載

最大 2.2GHz で動作するプレミアムな Arm Cortex-A78 を搭載した高性能オクタコア CPU 及び高度な 3D グラフィックスに対応可能。

2 LLM のエッジ AI 推論最適化

専用の AI プロセッサ (NPU) と NeuroPilot SDK を統合することで、エッジ環境への LLM デプロイを最適化し、最大 10 TOPS の AI 推論を実現。

3 シングル ISP による高精細マルチカメラ対応

最大 16MP @30fps のシングルカメラ構成をサポートし、IoT 分野において、コストと性能のバランスが取れた画像処理ソリューションを提供します。

部品番号	TBD
搭載 SoC	MediaTek Genio 520 Octo-Core Processor ・Dual-core Cortex-A78 SoC@ Max to 2.2GHz ・Hexa-core Cortex-A55 SoC@ Max to 2.0GHz
AI 性能	10 TOPS
メモリ	8GB / 16GB LPDDR5X
ストレージ	128GB UFS Flash Memory
OS	Android 15, Yocto 5.0, Debian 12
I/O	1x HDMI 2.0, 1x MIPI DSI (4-Lane), 2x MIPI CSI-2 (4-Lane & 2-Lane), 2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0, 1x PCIe Gen3 (1-Lane), 1x GLAN, 1x SDIO, 2x SPI, 4x UART, 4x I2C, 12x GPIO, 2x CAN-FD, 1x I2S
使用環境	稼働温度: 0°C ~ 60°C 稼働湿度: 0% ~ 95% (結露なきこと)
外形寸法	82mm x 50mm (SMARC)

高性能 SOM モジュール

SOM-5000



MediaTek Genio 700	eMMC 16GB
LPDDR4 4GB/8GB	GLAN ×1



MEDIATEK



1 MediaTek Genio 700 オクタコア SoC 搭載

最大 2.2GHz で動作するプレミアムな Arm Cortex-A78 プロセッサを搭載した高性能オクタコア CPU および高度な 3D グラフィックスに対応可能。

2 TOPS 4.0 の AI エンジン搭載

AI 演算を特化した APU を搭載して TOPS 4 の AI パフォーマンス。ハードウェア処理によって低消費電力で高いパフォーマンスを発揮することが可能。

3 高速バス対応

PCI-Express3.0/2.0 と USB 3.1 と GbE と 4K@60Hz 再生 などのさまざまな高速インターフェースを使用可能。

部品番号	4G : 10GQR22S40020 8G : 10GQR22S30020
搭載 SoC	MediaTek Genio 700 Octa-Core Processor ・Dual-Core Cortex-A78 SoC@ 2.2GHz ・Hexa-Core Cortex-A55 SoC@ 2.0GHz
メモリ	4GB/ 8GB LPDDR4X SDRAM
ストレージ	16GB eMMC
グラフィック	ARM Mali-G57 MC3
OS	Android 13 / Yocto 4.0 / Debian 12
I/O	2 MIPI DSI, 2 MIPI CSI-2, HDMI, Display Port, USB 3.1, 3 USB 2.0, GLAN, 2 SPI, 2 I2S, 3 I2C, 2 UART, 2 PCIe, SDIO, 4.3V DC-in
使用環境	稼働温度 : 0°C~60°C (広温度範囲対応可能) 稼働湿度 : 0%~95% @45°C (結露なきこと)
外形寸法	82mm x 50mm (SMARC)

高能率 7TOPS 推論・省電力エッジ SOM モジュール

SOM-4200



MediaTek Genio 420	128GB UFS storage
Up to LPDDR5 16GB	GLAN ×1



MEDIATEK



現在開発中のため、
製品仕様は一部変更となる可能性があります。

1 MediaTek オクタコア Genio 420 SoC 搭載

プレミアムな Arm Cortex-A78 を搭載した高性能オクタコア CPU 及び高度な 3D グラフィックスに対応可能。

2 LLM のエッジ AI 推論最適化

専用の AI プロセッサ (NPU) と NeuroPilot SDK を統合することで、エッジ環境への LLM デプロイを最適化し、最大 7 TOPS の AI 推論を実現。

3 シングル ISP による高精細マルチカメラ対応

最大 16MP @30fps のシングルカメラ構成をサポートし、IoT 分野において、コストと性能のバランスが取れた画像処理ソリューションを提供します。

部品番号	TBD
搭載 SoC	MediaTek Genio 420 Octo-Core Processor ・Dual-core Cortex-A78 SoC@ 1.8GHz ・Hexa-core Cortex-A55 SoC@ 1.6GHz
AI 性能	7 TOPS
メモリ	8GB / 16GB LPDDR5X
ストレージ	128GB UFS Flash Memory
OS	Android 15, Yocto 5.0, Debian 12
I/O	1x HDMI 2.0, 1x MIPI DSI (4-Lane), 2x MIPI CSI-2 (4-Lane & 2-Lane), 2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0, 1x PCIe Gen3 (1-Lane), 1x GLAN, 1x SDIO, 2x SPI, 4x UART, 4x I2C, 12x GPIO, 2x CAN-FD, 1x I2S, 1x PCIe Gen3 (1-Lane), 2x USB 2.0, 1x PCIe Gen3 (1-Lane)
使用環境	稼働温度 : 0°C ~ 60°C 稼働湿度 : 0% ~ 95% (結露なきこと)
外形寸法	82mm x 50mm (SMARC)

マルチプラットフォーム対応・高拡張性評価基板

SOMDB8



Multiple SoM platform support

Type C with PD support

Supports CAN-FD

GLAN x 2



現在開発中のため、製品仕様は一部変更となる可能性があります。

1 多彩な接続性

M.2 スロットを複数備え、5G/LTE、Wi-Fi、SSD などの柔軟な拡張が可能。

2 高度なビデオ出力

HDMI 2.1 コンバーターを搭載し、MIPI DSI や LVDS と合わせたマルチディスプレイ構成をサポート。

3 産業向けインターフェース

CAN-FD 対応の MCU や、デバッグに便利なコンソール、複数の USB ポートを装備。

部品番号	TBD
搭載 SoC	SOM 規格準拠
AI 性能	SOM 規格準拠
メモリ	SOM 規格準拠
ストレージ	SOM 規格準拠
OS	SOM 規格準拠
I/O	1x LVDS/MIPI DSI Combo, 1x 4-Lane MIPI CSI-2, 1x HDMI, 1x USB 3.2 (Type-C support PD), 1x USB 3.2, 2x USB 2.0, 1x Micro USB 2.0 (Download key), 1x M.2 2242 M-Key (For PCIe SSD), 1x M.2 E-Key, 1x M.2 B-Key, 2x GLAN, 1x SIM slot, 1x MicroSD card slot, 1x 9-pin D-sub (CAN-FD), 1x 3.5mm Audio jack
使用環境	稼働温度：0° C ~ 60° C 稼働湿度：0% ~ 95% (結露なきこと)
外形寸法	151mm x 134mm

Alder Lake-N 搭載・高能率 x86 演算 SOM モジュール

SOM-7X25



Intel Atom x7211E

Up to 64GB eMMC storage

Up to LPDDR5 16GB

GLAN x2

intel
INSIDE



現在開発中のため、製品仕様は一部変更となる可能性があります。

1 Intel Atom x7211E (Alder Lake-N) プロセッサ搭載

高効率な Gracemont CPU マイクロアーキテクチャを採用し、ベース 1.0GHz から最大 3.2GHz の高速処理を実現。

2 OpenVINO™対応

Intel® UHD Graphics と連携し、高速な AI 推論を実現。

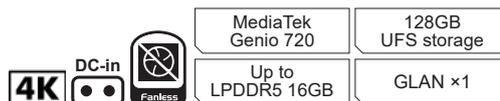
3 高速ネットワーク

2.5GbE LAN コントローラ搭載で、大容量データの転送に最適。

部品番号	TBD
搭載 SoC	Intel Atom® x7211E(Alder Lake-N, Max 3.2GHz)
AI 性能	(Supported by Intel® UHD Graphics & OpenVINO™)
メモリ	8GB / 16GB LPDDR5 4800MT/s
ストレージ	32GB / 64GB eMMC 5.1
OS	Windows 11, Yocto Linux
I/O	1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x LVDS(Dual CH), 2x USB 3.2 Gen2, 6x USB 2.0, 1x PCIe Gen3, 1x SATA, 1x 2.5GbE LAN, 2x CAN, 2x UART, 12x GPIO, 1x SMBus, 1x I2C, 1x SPI
使用環境	稼働温度：0° C ~ 60° C 稼働湿度：0% ~ 95% (結露なきこと)
外形寸法	82mm x 50mm (SMARC)

次世代標準 10 TOPS・エッジ最高峰 LLM 特化 OSM

OSM-7200



MEDIATEK



現在開発中のため、
製品仕様は一部変更となる可能性があります。

1 Genio 720 搭載：ハイエンド AI-IoT を実現する次世代 OSM

最大 2.6GHz の Cortex-A78 オクタコアと強力な 3D グラフィクス性能を業界標準の OSM 規格に凝縮し、コネクタレスな LGA 実装により圧倒的な耐振性と放熱信頼性を実現した高付加価値プラットフォーム。

2 LLM のエッジ AI 推論最適化

専用の AI プロセッサ (NPU) と NeuroPilot SDK を統合することで、エッジ環境への LLM デプロイを最適化し、最大 10 TOPS の AI 推論を実現。

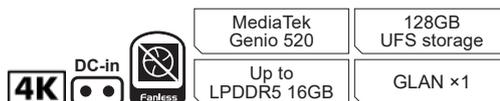
3 デュアル ISP による高精細マルチカメラ対応

16MP+16MP@30fps の同時処理が可能し、ステレオビジョンや高度な視覚認識を必要とするハイエンド IoT 機器に最適です。

部品番号	TBD
搭載 SoC	MediaTek Genio 720 Octo-Core Processor ・Dual-core Cortex-A78 SoC@ Max to 2.6GHz ・Hexa-core Cortex-A55 SoC@ 2.0GHz
AI 性能	10 TOPS
メモリ	8GB / 16GB LPDDR5X
ストレージ	128GB UFS Flash Memory
OS	Android 15, Yocto 5.0, Debian 12
I/O	1x LVDS/MIPI DSI Combo, 1x eDP, 1x MIPI CSI-2 (4-Lane), 2x USB 3.2, 2x USB 2.0, 1x PCIe (1-Lane), 1x GLAN, 2x SPI, 2x I2C, 4x UART, 12x GPIO (TBD), 2x I2S, 2x SDIO
使用環境	稼働温度 : 0°C ~ 60°C 稼働湿度 : 0% ~ 95% (結露なきこと)
外形寸法	OSM Size-L (45x45mm) LGA Type

次世代標準・高機能 ISP 搭載ビジョン最適化 OSM

OSM-5200



MEDIATEK



現在開発中のため、
製品仕様は一部変更となる可能性があります。

1 Genio 520 搭載：ハイエンド AI-IoT を実現する次世代 OSM

最大 2.2GHz の Cortex-A78 オクタコアと強力な 3D グラフィクス性能を業界標準の OSM 規格に凝縮し、コネクタレスな LGA 実装により圧倒的な耐振性と放熱信頼性を実現した高付加価値プラットフォーム。

2 LLM のエッジ AI 推論最適化

専用の AI プロセッサ (NPU) と NeuroPilot SDK を統合することで、エッジ環境への LLM デプロイを最適化し、最大 10 TOPS の AI 推論を実現。

3 シングル ISP による高精細マルチカメラ対応

最大 16MP @30fps のシングルカメラ構成をサポートし、IoT 分野において、コストと性能のバランスが取れた画像処理ソリューションを提供します。

部品番号	TBD
搭載 SoC	MediaTek Genio 520 Octo-Core Processor ・Dual-core Cortex-A78 SoC@ Max to 2.2GHz ・Hexa-core Cortex-A55 SoC@ Max to 2.0GHz
AI 性能	10 TOPS
メモリ	8GB / 16GB LPDDR5X
ストレージ	128GB UFS Flash Memory
OS	Android 15, Yocto 5.0, Debian 12
I/O	1x LVDS/MIPI DSI Combo, 1x eDP, 1x MIPI CSI-2 (4-Lane), 2x USB 3.2, 2x USB 2.0, 1x PCIe (1-Lane), 1x GLAN, 2x SPI, 2x I2C, 4x UART, 12x GPIO (TBD), 2x I2S, 2x SDIO
使用環境	稼働温度 : 0°C ~ 60°C 稼働湿度 : 0% ~ 95% (結露なきこと)
外形寸法	OSM Size-L (45x45mm) LGA Type

次世代標準 7 TOPS・省電力軽量推論エントリー OSM

OSM-4200



MediaTek Genio 420	128GB UFS storage
Up to LPDDR5 16GB	GLAN x1



現在開発中のため、製品仕様は一部変更となる可能性があります。

1 Genio 420 搭載：AI-IoT を実現する次世代 OSM

最大 1.8GHz の Cortex-A78 オクタコアと強力な 3D グラフィックス性能を業界標準の OSM 規格に凝縮し、コネクタレスな LGA 実装により圧倒的な耐振性と放熱信頼性を実現した高付加価値プラットフォーム。

2 LLM のエッジ AI 推論最適化

専用の AI プロセッサ (NPU) と NeuroPilot SDK を統合することで、エッジ環境への LLM デプロイを最適化し、最大 7 TOPS の AI 推論を実現。

3 シングル ISP による高精細マルチカメラ対応

最大 16MP @30fps のシングルカメラ構成をサポートし、IoT 分野において、コストと性能のバランスが取れた画像処理ソリューションを提供します。

部品番号	TBD
搭載 SoC	MediaTek Genio 420 Octo-Core Processor ・Dual-core Cortex-A78 SoC@ 1.8GHz ・Hexa-core Cortex-A55 SoC@ 1.6GHz
AI 性能	7 TOPS
メモリ	8GB / 16GB LPDDR5X
ストレージ	128GB UFS Flash Memory
OS	Android 15, Yocto 5.0, Debian 12
I/O	1x LVDS/MIPI DSI Combo, 1x eDP, 1x MIPI CSI-2 (4-Lane), 2x USB 3.2, 2x USB 2.0, 1x PCIe (1-Lane), 1x GLAN, 2x SPI, 2x I2C, 4x UART, 12x GPIO (TBD), 2x I2S, 2x SDIO
使用環境	稼働温度 :0° C ~ 60° C 稼働湿度 : 0% ~ 95% (結露なきこと)
外形寸法	OSM Size-L (45x45mm) LGA Type

LLM 特化型高性能シングルボードコンピュータ

VAB-5200



MediaTek Genio 520	128GB UFS storage
Up to LPDDR5 8GB	GLAN x1



現在開発中のため、製品仕様は一部変更となる可能性があります。

1 MediaTek オクタコア Genio 520 SoC 搭載

最大 2.2GHz で動作するプレミアムな Arm Cortex-A78 を搭載した高性能オクタコア CPU 及び高度な 3D グラフィックスに対応可能。

2 LLM のエッジ AI 推論最適化

専用の AI プロセッサ (NPU) と NeuroPilot SDK を統合することで、エッジ環境への LLM デプロイを最適化し、最大 10 TOPS の AI 推論を実現。

3 産業用向けの堅牢な設計

9 ~ 36VDC の広範囲な電源入力に対応し、-20° C から 60° C の過酷な環境下でも動作可能です。

部品番号	TBD
搭載 SoC	MediaTek Genio 520 Octo-Core Processor ・Dual-core Cortex-A78 SoC@ Max to 2.2GHz ・Hexa-core Cortex-A55 SoC@ Max to 2.0GHz
AI 性能	10 TOPS
メモリ	8GB / 16GB LPDDR5X
ストレージ	128GB UFS Flash Memory
OS	Android 15, Yocto 5.0, Debian 12
I/O	1x HDMI, 2x GLAN, 2x USB 3.1, 1x Micro USB 2.0, 1x 3.5mm audio jack, 1x MicroSD Slot, 1x 40-pin Raspberry Pi-type GPIO header, 1x 4-Lane MIPI CSI, 1x M.2 slot for optional 4G LTE/5G module, 1x Nano SIM card slot, 3x 40-pin B2B connectors for optional Wi-Fi/LVDS/eDP/CSI-to-AHD, 1x UART (debug)
使用環境	稼働温度 :0° C ~ 60° C 稼働湿度 : 0% ~ 95% (結露なきこと)
外形寸法	131.5mm x 82 mm (L x W)

高性能シングルボードコンピュータ

NEW

VAB-5000



MediaTek Genio 700

eMMC 16GB

LPDDR4 4GB/8GB

CSI x2



MEDIATEK



1 MediaTek Genio 700 オクタコア SoC 搭載

最大 2.2GHz で動作するプレミアムな Arm Cortex-A78 プロセッサを搭載した高性能オクタコア CPU および高度な 3D グラフィックスに対応可能。

2 TOPS 4.0 の AI エンジン搭載

AI 演算を特化した APU を搭載して TOPS 4 の AI パフォーマンス。ハードウェア処理によって低消費電力で高いパフォーマンスを発揮することが可能。

3 高速バス対応

USB 3.1 と GbE MAC などのさまざまな高速インターフェースを使用可能。4K@90Hz 再生。

部品番号	10GMU20600020
搭載 SoC	MediaTek Genio 700 Octa-Core Processor ・Dual-Core Cortex-A78 SoC@ 2.2GHz ・Hexa-Core Cortex-A55 SoC@ 2.0GHz
メモリ	4GB/ 8GB LPDDR4X SDRAM
eMMC	16GB eMMC
グラフィック	ARM Mali-G57 MC3
OS	Android 13 / Yocto 4.0 / Debian 12
I/O	eDP (Embedded DisplayPort), 2-Lane MIPI CSI, I/O expansion pin-header (supports GPIO x 40), UART, M.2 slot, Nano SIM card slot, Micro SD card slot, HDMI, 2 USB 3.1, GLAN, 3.5mm headphone jack, 12V DC in
使用環境	稼働温度：0°C~60°C 稼働湿度：0%~95% @45°C (結露なきこと)
外形寸法	100mm x 72mm (Pico-ITX)

高性能 AI エンジン搭載エッジゲートウェイ

ARTiGO A5000



MediaTek Genio 700

eMMC 16GB

LPDDR4 8GB

GLAN x 1



MEDIATEK



1 MediaTek Genio 700 オクタコア SoC 搭載

要求の厳しい AI やパフォーマンスを重視する IoT アプリケーション向けに設計された、最大 2.2GHz で動作するプレミアムな Arm Cortex-A78 プロセッサを搭載した高性能オクタコア CPU および高度な 3D グラフィックスに対応可能。

2 TOPS 4.0 の AI エンジン搭載

AI 演算を特化した APU を搭載して TOPS 4 の AI パフォーマンス。ハードウェア処理によって低消費電力で高いパフォーマンスを発揮することが可能。

3 コンパクトなスマートボックス

アンテナをシャーシに内蔵することで、小型化を実現したコンパクトシステム。

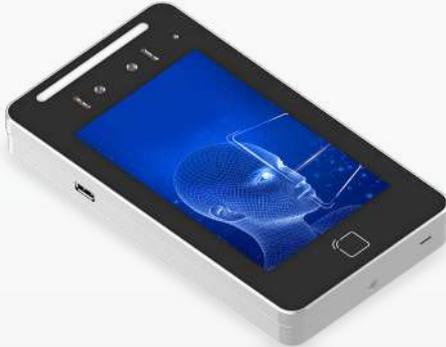
部品番号	ATG-A5000-LE08A0
搭載 SoC	MediaTek Genio 700 Octa-Core Processor ・Dual-Core Cortex-A78 SoC@ 2.2GHz ・Hexa-Core Cortex-A55 SoC@ 2.0GHz
メモリ	8GB LPDDR4 SDRAM
ストレージ	16GB eMMC
グラフィック	ARM Mali-G57 MC3
OS	Android 13 / Yocto 4.0 / Debian 12
I/O	Micro SD connector, Micro USB 2.0 port, Power button, Reset button, Download button, 12V DC In connector, GLAN port, 2 USB 3.0 ports, HDMI Port, 3.5mm phone jack (HPO/MIC)
使用環境	稼働温度：0°C~60°C 稼働湿度：0%~90% @45°C (結露なきこと)
外形寸法	117.92mm x 37.6mm x 80.8mm(WxHxD)

アクセス制御システム

ACS-5000



MediaTek Genio 700	eMMC 16GB
LPDDR4 8GB	WLAN+BT



1 MediaTek Genio 700 オクタコア SoC 搭載

要求の厳しい AI やパフォーマンスを重視する IoT アプリケーション向けに設計された、最大 2.2GHz で動作するプレミアムな Arm Cortex-A78 プロセッサを搭載した高性能デュアルコア CPU および高度な 3D グラフィックスに対応可能。

2 複数カメラの搭載によるセキュリティ向上

RGB カメラと IR カメラ、二つのカメラを搭載し、複数のカメラによる顔認証の精度向上を図ることで、なりすましをより確実に防止します。不正なアクセスを検知し、より信頼性の高いセキュリティを実現します。

3 セキュリティ非接触型スマートカードリーダー

ISO 14443 Type A 非接触型カードをサポート可能。

部品番号	TBD
搭載 SoC	MediaTek Genio 700 Octa-Core Processor ・Dual-Core Cortex-A78 SoC@ 2.2GHz ・Hex-Core Cortex-A55 SoC@ 2.0GHz
メモリ	8GB LPDDR4 SDRAM
モニター	7.0" 1200x1920 10:16 LCD
eMMC	16GB
OS	Android 13
I/O	2 MIPI 1080p / 30fps camera(RGB+IR), 1 USB 2.0 Type A, 1 RJ45, 2 GPI Input (10mA), 2 GPO Output (max. 3A), 1 RS-485, 1 UART for debug, 1 Micro USB, 12V DC-IN
NFC	ISO / IEC 14443 Type A/B
使用環境	稼働温度：0°C~50°C 稼働湿度：0%~90% @45°C (結露なきこと)
外形寸法	230mm x 129mm x 28mm(WxHxD)

x86 クアッドコア搭載マザーボード

EPIA-M930



Intel Celeron J6413	COM x 2
LVDS x 2	GLAN x 2



1 Intel クアッドコア CPU 搭載

Intel 社製 1.8GHz Celeron クアッドコアプロセッサ J6413 搭載。TDP はわずか 10W、高性能・低消費電力両立可能。

2 豊富な I/O および拡張

2つの USB 3.1 ポート、4つの COM ポート及び 8 ビットデジタル I/O を備えています。また、高速ネットワークに対応するギガビットイーサネットを2つ搭載しています。

3 2LVDS マルチ画面出力対応

産業用途に必要なとされる LVDS パネルとの接続ポートを2つ搭載。HDMI と組み合わせをすれば3つ画面への出力も可能。

部品番号	10GQH18F000A0
搭載 CPU	Intel Celeron Processor J6413 1.8GHz
メモリ	Max 32GB DDR4 SODIMM
グラフィック	第 10 世代インテル® プロセッサ・ファミリー用インテル® Core™ UHD グラフィックス
I/O	1 HDMI, 2 LVDS, 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 4 COM, 2 GLAN, 8 GPIO, PCIe x1 slot, SATA, 2 M.2 slots, SIM card slot, Audio jack, 12V DC-in
使用環境	稼働温度：0°C~60°C 稼働湿度：0%~95% @45°C (結露なきこと)
外形寸法	170mm x 170mm (Mini-ITX)

NVIDIA ファンレス・コンパクトシステム

AMOS-9100 Series

4K

DC-in



Nvidia
Jetson Orin NX

LDDR5 8GB

NVIDIA Ampere
architecture GPU

DC-in 12V-24V

ARM
POWERED



1 高性能 AI 処理能力 SoC

最大 100 TOPS の AI パフォーマンスで、複雑なタスクも迅速に処理。

2 柔軟な電力設定

10W から 25W までの電力設定が可能で、用途に応じた最適化が可能。

3 優れた拡張性

ロボティクスや自動運転車、産業用アプリケーションに対応する高い拡張性。

部品番号	AMOS-9100-1H11A0 / AMOS-9101-1H11A0
搭載 SoC	2.0GHz NVIDIA Jetson Orin NX Cortex®-A78AE Hexa-Core
メモリ	8GB LPDDR5 DRAM / 16GB LPDDR5 DRAM
Storage	128GB SSD
OS	JetPack SDK 6.1
I/O	1 HDMI 2.0 connector, 3 USB 3.2 Type-A ports, 1 USB Type C port, 1 Micro USB 2.0 port (for debugging), 2 RS-232/422/485 (switch for select), 2 Ethernet ports (PoE manufacture option), 1 Micro SIM slot, 2 COM, 1 CAN/UART, 4 DI/DO, 2 LEDs (power, programable), 1 MIC / HP out, 3 buttons (power on/off, recovery, reset), 4 5G-antenna connectors, 2 Wi-Fi antenna / 1 BT antenna connector, 1 2-pole Phoenix DC-in
使用環境	稼働温度：-20°C~60°C 稼働湿度：0%~95% (結露なきこと)
外形寸法	160mm x 66.7mm x 105.2mm (WxHxD)

NVIDIA ファンレス・コンパクトシステム

AMOS-9000

4K

DC-in



Nvidia
Jetson Orin Nano

LDDR5 8GB

NVIDIA Ampere
architecture GPU

DC-in 12V-24V

ARM
POWERED



1 相当 AI 処理能力 SoC

AI パフォーマンスは最大 40 TOPS を実現し、NVIDIA Jetson Nano の最大 80 倍のパフォーマンスが得られます。

2 優れた電力効率

7W から 15W までの電力構成で、低消費電力でありながら、AI を実現。

3 柔軟な適用範囲

エッジ AI、スマートカメラ、IoT デバイスに最適。

部品番号	AMOS-9000-1H11A0
搭載 SoC	1.5GHz NVIDIA Jetson Orin Nano Cortex®-A78AE Hexa-Core
メモリ	8GB LPDDR5 DRAM
Storage	128GB SSD
OS	JetPack SDK 6.1
I/O	1 HDMI 2.0 connector, 3 USB 3.2 Type-A ports, 1 USB Type C port, 1 Micro USB 2.0 port (for debugging), 2 RS-232/422/485 (switch for select), 2 Ethernet ports (PoE manufacture option), 1 Micro SIM slot, 2 COM, 1 CAN/UART, 4 DI/DO, 2 LEDs (power, programable), 1 MIC / HP out, 3 buttons (power on/off, recovery, reset), 4 5G-antenna connectors, 2 Wi-Fi antenna / 1 BT antenna connector, 1 2-pole Phoenix DC-in
使用環境	稼働温度：-20°C ~ 60°C 稼働湿度：0%~90% @45°C (結露なきこと)
外形寸法	150mm x 66.7mm x 105.2mm (WxHxD)

x86 ファンレス・コンパクトシステム

AMOS-3007



Intel ATOMX6413E	COM x2
HDMI x2	GLAN x2

intel
INSIDE



1 Intel クアッドコア CPU 搭載

Intel 社製 1.5GHz ATOM クアッドコアプロセッサ X6413E 搭載。TDP はわずか 9W、高性能・低消費電力両立可能。

2 豊富な I/O および拡張

2つの USB 3.1 ポート、4つの COM ポート及び 8ビットデジタル I/O を備えています。また、高速ネットワークに対応するギガビットイーサネットを2つ搭載しています。

3 -20°C~70°Cワイドレンジ温度対応

システムの稼働温度は -20°C~70°Cまで幅広いため、温度に厳しい屋外用、半屋外用にも対応可能。

部品番号	AMOS-3007-1Q15A0
搭載 CPU	Intel Atom Processor X6413E 1.5GHz
メモリ	Max 32GB DDR4 SODIMM
グラフィック	第10世代インテル® プロセッサ・ファミリー用インテル® Core™ UHD グラフィックス
I/O	2 HDMI, 2 USB 3.1, 2 Lockable USB 2.0 ports, 2 COM ports for RS-232/422/485, 2 Gigabit Ethernet, 1 DIO port for 8-bit GPIO, 1 Line-out, 1 Mic-in, 9-36V DC-in
使用環境	稼働温度: -20°C~70°C 稼働湿度: 0%~95% @45°C (結露なきこと)
外形寸法	170mm x 48.5mm x 126mm(WxHxD)

MediaTek ファンレス・コンパクトシステム

AMOS-5200



MediaTek Genio 520	128GB UFS storage
Up to LPDDR5 8GB	GLAN x1

ARM
POWERED

MEDIATEK



現在開発中のため、
製品仕様は一部変更となる可能性がございます。

1 MediaTek オクタコア Genio 520 SoC 搭載

最大 2.2GHz で動作するプレミアムな Arm Cortex-A78 を搭載した高性能オクタコア CPU 及び高次元な 3D グラフィックスに対応可能。

2 LLM のエッジ AI 推論最適化

専用の AI プロセッサ (NPU) と NeuroPilot SDK を統合することで、エッジ環境への LLM デプロイを最適化し、最大 10 TOPS の AI 推論を実現。

3 産業用向けの堅牢な設計

9~36VDC の広範囲な電源入力に対応し、-20°C から 60°C の過酷な環境下でも動作可能です。

部品番号	TBD
搭載 SoC	MediaTek Genio 520 Octo-Core Processor ・Dual-core Cortex-A78 SoC@ Max to 2.2GHz ・Hexa-core Cortex-A55 SoC@ Max to 2.0GHz
AI 性能	10 TOPS
メモリ	4GB/8GB LPDDR5X
ストレージ	128GB UFS Flash Memory
OS	Android 15, Yocto 5.0, Debian 12
I/O	1x HDMI, 2x GLAN, 2x USB 3.1, 1x Micro USB 2.0, 1x 3.5mm audio jack, 1x MicroSD Slot, 1x 4-Lane MIPI CSI, 1x M.2 slot for optional 4G LTE/5G module, 1x Nano SIM card slot, 1x AHD camera jack, 1x LVDS port, 1x UART (debug), 1x Power button, 1x Reset button, 1x Download button
使用環境	稼働温度: -20°C ~ 60°C 稼働湿度: 0% ~ 95% (結露なきこと)
外形寸法	TBD

VIA Mobile360

製品

一体型 AI ドライブレコーダー

VIA Mobile360 D800



ADAS+DSS
2カメラ

CAN bus 搭載

4G LTE 対応

DC-in 9V-36V



現在開発中のため、
製品仕様は一部変更となる可能性があります。

1 次世代 AI 性能

MediaTek Genio 520 (10 TOPS) 搭載。最大 3 チャンネルカメラ入力対応。

2 4K 高画質録画

最大 4K 解像度での記録と AI 解析を同時処理し、証拠能力を向上。

3 フルコネクティビティ

4G LTE、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3 標準搭載。クラウド運行管理とシームレスに連携。

部品番号	TBD
搭載 SoC	MediaTek Genio 520 (Octa-Core)
AI 性能	10 TOPS (MediaTek NPU 850)
メモリ	8GB DRAM
ストレージ	64GB UFS (System) Micro SD Slot (Data, Max 512GB)
OS	Android (Ver TBD)
Display	2 インチ LCD
Camera In	1x Main Camera (Built-in) 1x Sub Camera Input, 1x Rear Camera Input (AHD)
I/O (Data/Net)	1x USB Type-C (DP Alt Mode / Data) 1x USB Type-C (Debug)
Wireless	4G LTE Cat.4, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GNSS
使用環境	働温度: -10°C ~ 70°C 耐振動: ISO-16750-3 準拠 (※電源保護 ISO 16750-2 対応)
外形寸法	(詳細サイズ要確認 / 小型 AI ドラレコ筐体)

AI フォークリフト安全システム

VIA Mobile360 M500



IP67 対応

ISO 16750-3
振動・衝撃

DDR3 1GB

DC-in 9V-36V



1 VIA WorkX Connect App 対応

VIA WorkX Connect App で設定、キャリブレーションを簡単に。

2 AI 検知システム搭載

PD (歩行者検知) & DSS (ドライバー安全) カメラによって、フォークリフトに接近する歩行者を検知して警告し、ドライバーの安全意識を高めます。

3 豊富多様なオプション

PDカメラ、DSSカメラ、7インチディスプレイパネル、スピードセンサーキットなど、ニーズに合わせた多彩な組合せが選べます。

部品番号	M360-M500 (with 2PD+DSS) M360-M500 (with 3PD)
搭載 SoC	1.2GHz ARM Cortex-A7 dual-core SoC with deep learning accelerator
メモリ	1GB DDR3 SDRAM
Storage	512MB SPI NAND Flash ROM 1 Micro SD Card Slot (Max 512GB)
OS	Embedded Linux
I/O	2 M12 8-pin DIO avionic connectors, 1 M12 CAN/COM avionic connector, 1 M12 speaker avionic connector, 1 Micro SD card slot, 1 Micro SIM card slot, 9-36V DC-in
使用環境	稼働温度: -20°C~60°C 稼働湿度: 0%~95% (結露なきこと)
外形寸法	178mm x 53.8mm x 194.6mm (WxHxD)

VIA Mobile360 J600



ADAS+DSS
2カメラ

CAN bus 搭載

4G LTE 対応

DC-in 9V-36V

ARM
POWERED



1 建機特化 I/O

最大 6 チャンネル AHD カメラ入力、CAN バス、電源を 1 つのコネクタに集約。配線作業を劇的に簡素化。

2 堅牢設計

IP66 の防水防塵性能と ISO-16750-3 準拠の耐振動性を装備。

3 優れた操作性

手袋でも操作可能な 8 インチ高輝度タッチパネルを採用。

部品番号	TBD
搭載 SoC	MediaTek Genio 700 (Octa-Core)
AI 性能	4.0 TOPS (NPU + MDLA 3.0)
メモリ	4GB / 8GB LPDDR4X SDRAM
ストレージ	16GB eMMC (System) Micro SD Slot (Data)
OS	Yocto 4.0.17
Display	8.0 インチ TFT LCD (1280x720) 静電容量式タッチパネル
Camera In	4x AHD Camera Input(Supports 720p/1080p)
I/O (Data/Net)	1x USB 3.0 Type-A, 1x Micro USB (Debug) 1x CAN Bus, 1x RS-232, 1x RS-485DIO, ACC/IGN
Wireless	4G LTE (M.2 B-Key), Wi-Fi/BT, GPS (Onboard)
使用環境	稼働温度：-20° C ~ 70° C 耐振動：ISO-16750-3 準拠 防水防塵：IP66 (Front Panel)
外形寸法	220mm x 166mm x 37mm(WxHxD / 突起部含まず)

📍 お問い合わせ先

📍 Japan

VIA Technologies Japan株式会社

〒150-0011 東京都渋谷区
東3丁目15番7号
ヒューリック恵比寿ビル6階

- Tel: 81-3-5466-1637
- Fax: 81-3-5466-1638
- embedded@viatech.co.jp

📍 Taiwan Headquarters

威盛電子股份有限公司

1F, 531, Zhongzheng Rd.,
Xindian Dist.
New Taipei City 231, Taiwan

- Tel: 886-2-2218-5452
- Fax: 886-2-2218-9860
- contact_us@viatech.com

📍 USA

VIA Technologies, Inc.

940 Mission Court, Fremont,
CA 94539, USA

- Tel: 1-510-687-4688
- Fax: 1-510-687-4654
- contact_us@viatech.com

📍 China

VIA Technologies Co., Ltd.

Tsinghua Science Park Building 7
No.1 Zhongguancun East Road,
Haidian District, Beijing,
100084 P.R.C

- Tel: 86-10-59852288
- Fax: 86-10-59852299
- embedded@viatech.com.cn